2026年12月期　第3四半期

決算説明資料

株式会社 RS Technologies　プライム市場 3445

2026年11月13日

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

目 次

01 決算概要 P.03

02 中期経営計画
（26年～28年） P.08

03 会社概要 P.20

04 Appendix P.49

＊第3四半期　主な更新ページ：業績（P4～7）、プライムウェーハ事業（P36～38）、エネルギー事業（P44）

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2026年12月期　第3四半期
決算概要

01

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2026年12月期　第3四半期　決算概況

- 連結通期業績予想に変更はなく、第3四半期は計画達成に向けて進捗。

（百万円）	2025年12月期 第3四半期	2026年12月期 第3四半期	前年同期比	差額
売上高	58,583	**65,021**	11.0%	6,438
売上原価	40,574	**44,839**	10.5%	4,265
売上総利益	18,008	**20,182**	12.1%	2,174
販売管理費	6,945	**7,582**	9.2%	637
営業利益	11,062	**12,599**	13.9%	1,537
営業外収益	① 2,360	**1,996**	-15.4%	-364
営業外費用	② 1,404	**1,319**	-6.1%	-85
経常利益	12,018	**13,276**	10.5%	1,258
親会社株主に帰属する四半期純利益	③ 6,669	**7,917**	18.7%	1,248
一株当たり四半期純利益（円）	252.22	**297.86**	18.1%	45.64

Topics

①
-補助金収入(政府からGRITEKへ)
1,152百万円→**882百万円**

-為替差益
0百万円→**21百万円**

②
-為替差損
462百万円→**0百万円**

-持分法による投資損失（中国12インチ事業SGRS）
780百万円→**996百万円**
（損益は当社持分比率に応じて連結業績へ取り込まれます）

➢増産に向けた設備投資により損失は増加したものの、
12インチプライムウェーハの販売数量及び単価は、
第2四半期に引き続き前年同期を上回る水準で推移

③
-負ののれん発生益
367百万円→**1,585百万円**

➢2026年7月に取得した安徽省Epiハウス（プライムウェーハ事業）の
連結時時価純資産額が取得原価を上回ったため、
その差額を負ののれん発生益として計上
（取得価格：約10,691百万円　RMB＝23.72 JPYで換算）

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2026年12月期　第3四半期　セグメント動向

- ウェーハ再生事業

第2四半期に実施した三本木第7工場再稼働に向けた一時的な整備費用（前年同期比＋約239百万円）に加え、設備投資に伴う減価償却費増加により営業利益率は低下。
一方、高稼働の継続及び販売数量増加によりその他のコスト上昇を吸収し、一時費用を除いたEBITDAマージンは前年同期比で同水準を維持。

- プライムウェーハ事業

8インチプライムウェーハ及びエッチング装置消耗部品用シリコン部材は、需要拡大や設備投資を背景に販売数量が増加し、増収増益。
8インチプライムウェーハは、高付加価値製品の構成比上昇が、足元の平均販売単価改善に寄与。

- 半導体関連装置・部材等事業

RSPDHの当社計画に基づく光ピックアップモジュールの減産が、当セグメント前年同期比減収減益の主要因。
エネルギー事業は、VRFB用電解液販売やコンサルティング事業の貢献により、売上高は前年同期比で2倍超、営業損失は大幅に縮小。
商社ビジネス・DG Technologiesは、製品ごとに強弱はあったものの、全体として低調に推移。

（百万円）

	ウェーハ再生事業	前年同期比	プライムウェーハ製造販売事業	前年同期比	半導体関連装置・部材等事業	前年同期比	その他、調整額	前年同期比	連結合計	前年同期比
売上高	21,861	+7.1%	22,842	+49.8%	21,969	△9.5%	△1,652	－	**65,021**	**+11.0%**
営業利益	7,668	+3.3%	5,235	+58.0%	1,182	△27.2%	△1,486	－	**12,599**	**+13.9%**
営業利益率	35.1%	△1.3pt	22.9%	＋1.2pt	5.4%	△1.3pt	―	－	**19.4%**	**+0.5pt**

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

2026年12月期　第3四半期　セグメント別動向　四半期実績グラフ

- ウェーハ再生事業

台南工場の増産設備投資（月産2万枚増）に加え、再生ウェーハの平均単価が数%上昇し、前四半期比増収増益。
三本木第7工場は11月から順次稼働を開始し、第4四半期末には月産4万枚体制を構築予定。

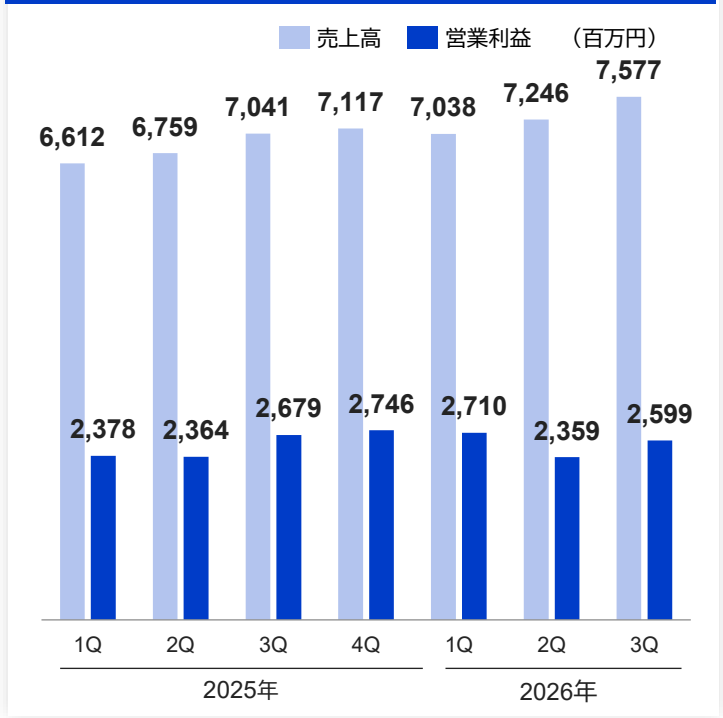
- プライムウェーハ事業

8インチプライムウェーハの販売数量は、過去最高の月産28万枚超を記録（第2四半期：月産27万枚）。 第4四半期末計画の月産30万枚体制への移行準備も順調に進捗。
シリコン部材は販売量増加により増収、売上高構成比も上昇し業績に貢献した一方、7月に連結化したEpiハウスが立上げフェーズにあり損失を計上したことから、セグメント利益率は前四半期比で低下。

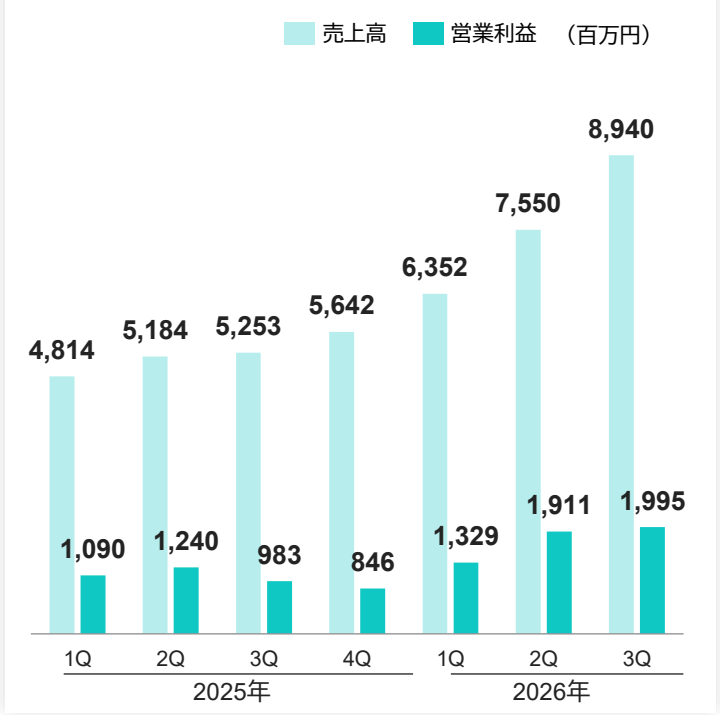
- 半導体関連装置・部材等事業

RSPDHの光ピックアップモジュールは、当社の生産計画に基づき、第3四半期の生産数量が前四半期比で増加し、増収増益に寄与。
エネルギー事業は、コンサルティング事業、及び浪江工場から海外向けに出荷したVRFB用電解液（約60百円）が収益に貢献。中国攀枝花工場は11月より稼働開始し、来期出荷開始に向けた準備が進捗。

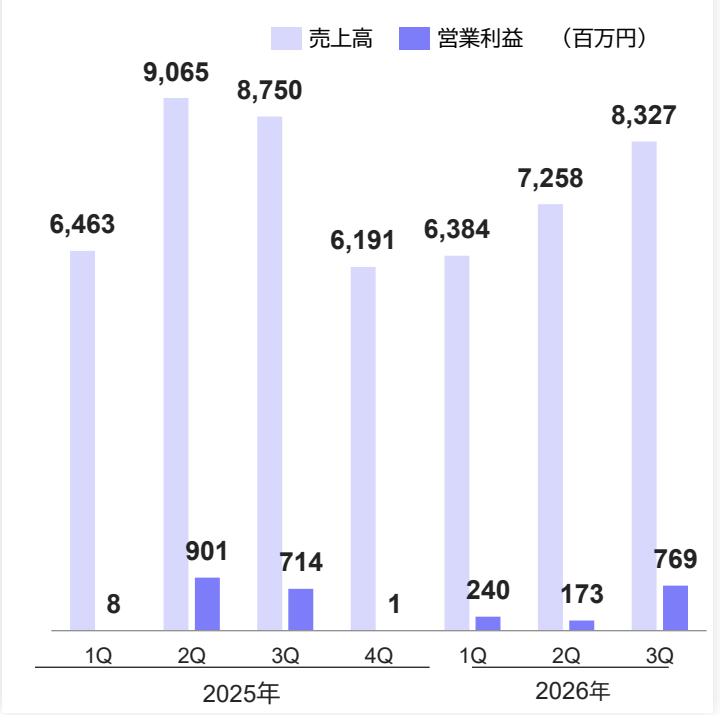
ウェーハ再生事業



プライムウェーハ事業



半導体関連装置・部材等事業



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

貸借対照表

- 純資産は、前年期末比314億5,000万円増の1,847億8,100万円となった。

（百万円）

連結貸借対照表

	2025年12月期末	2026年12月期 第3四半期
流動資産	135,354	**142,076**
現金及び預金	96,771	**98,931**
受取手形及び売掛金	22,322	**26,512**
商品及び製品	5,677	**5,312**
固定資産	69,867	**94,540**
有形固定資産	49,485	**71,781**
無形固定資産	669	**697**
投資その他資産	19,712	**22,062**
資産合計	205,222	**236,617**
流動負債	31,286	**30,428**
支払手形及び買掛金	9,890	**11,262**
有利子負債	7,300	**3,518**
固定負債	20,605	**21,406**
有利子負債	16,140	**16,351**
負債合計	51,891	**51,835**
純資産	153,331	**184,781**
負債･純資産合計	205,222	**236,617**

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

中期経営計画

02

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

中期経営計画 (2026-2028)

- この3カ年を成長加速に向けた集中投資フェーズと位置付け、ウェーハ再生事業へ大規模な資本投下を実施
- 2027年以降は、新規のM&Aを含めた成長を想定

	(百万円)	2024年 12月期 (実績)	2025年 12月期 (実績)	2026年 12月期予算	2027年 12月期予算	2028年 12月期予算
収益性	**売上高**	**59,200**	**76,707**	**84,000**	**105,000**	**115,000**
	営業利益	**13,108**	**14,281**	**15,400**	**17,500**	**19,000**
	営業利益率	*22.1%*	*18.6%*	*18.3%*	*16.7%*	*16.5%*
	経常利益	**15,668**	**16,635**	**17,200**	**19,000**	**20,000**
	経常利益率	26.5%	21.7%	20.5%	18.1%	17.4%
	親会社に帰属する当期純利益	**9,446**	**9,297**	**10,000**	**11,500**	**13,000**

効率性	**ROIC**	12.7%	10.8%	**11%以上**
	ROE	15.2%	12.5%	**13%以上**

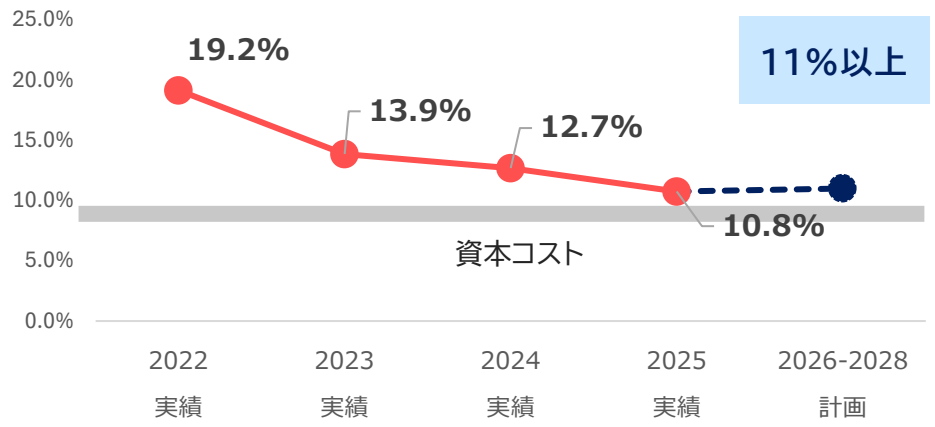
COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

資本収益性と資本コスト（現状分析・評価）

- 現在は投資先行局面にあるが、ウェーハ再生事業を中心とした大型投資の収益化や資本効率改善により、ROIC向上を目指す
- 2026年～2028年でROIC11%以上、ROE13%以上をターゲットに改善に向けた取り組みを実施予定

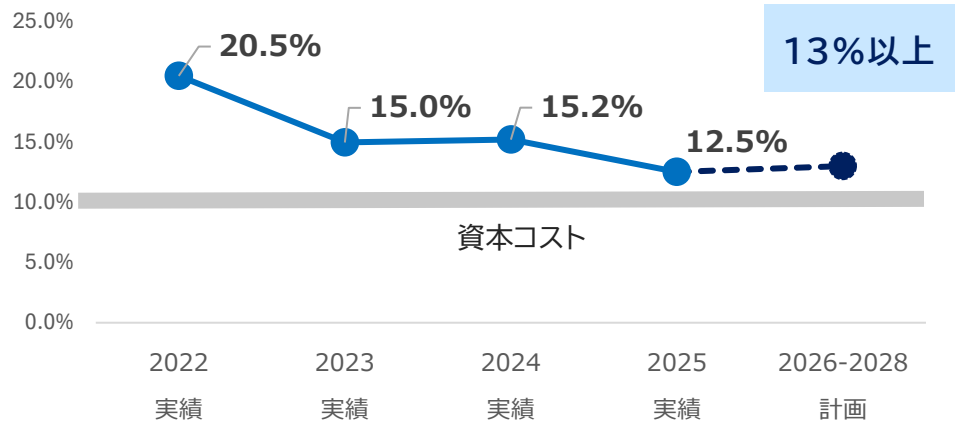
資本利益率

ROIC



*ROIC= NOPAT÷投下資本（自己資本＋有利子負債期首期末平均）

ROE



*ROE= 親会社に帰属する当期純利益÷ 自己資本期首期末平均

資本コスト

当社 WACC	9.0 %

*WACC=株主資本コストx株主資本/(投下資本)＋負債コストx有利子負債/(投下資本)x(1-実効税率)を基に算出し、9.0%で設定

当社 株主資本コスト	10.5 %

*株主資本コスト=リスクフリーレート＋ベータ値 xリスクプレミアムを基に算出し、10.5%で設定

*ROICの分母にあたる投下資本を(株主資本＋有利子負債)から(自己資本＋有利子負債期首・期末平均)に変更。ROEの計算式は有価証券報告書にあわせて分母を自己資本期首期末平均に統一

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

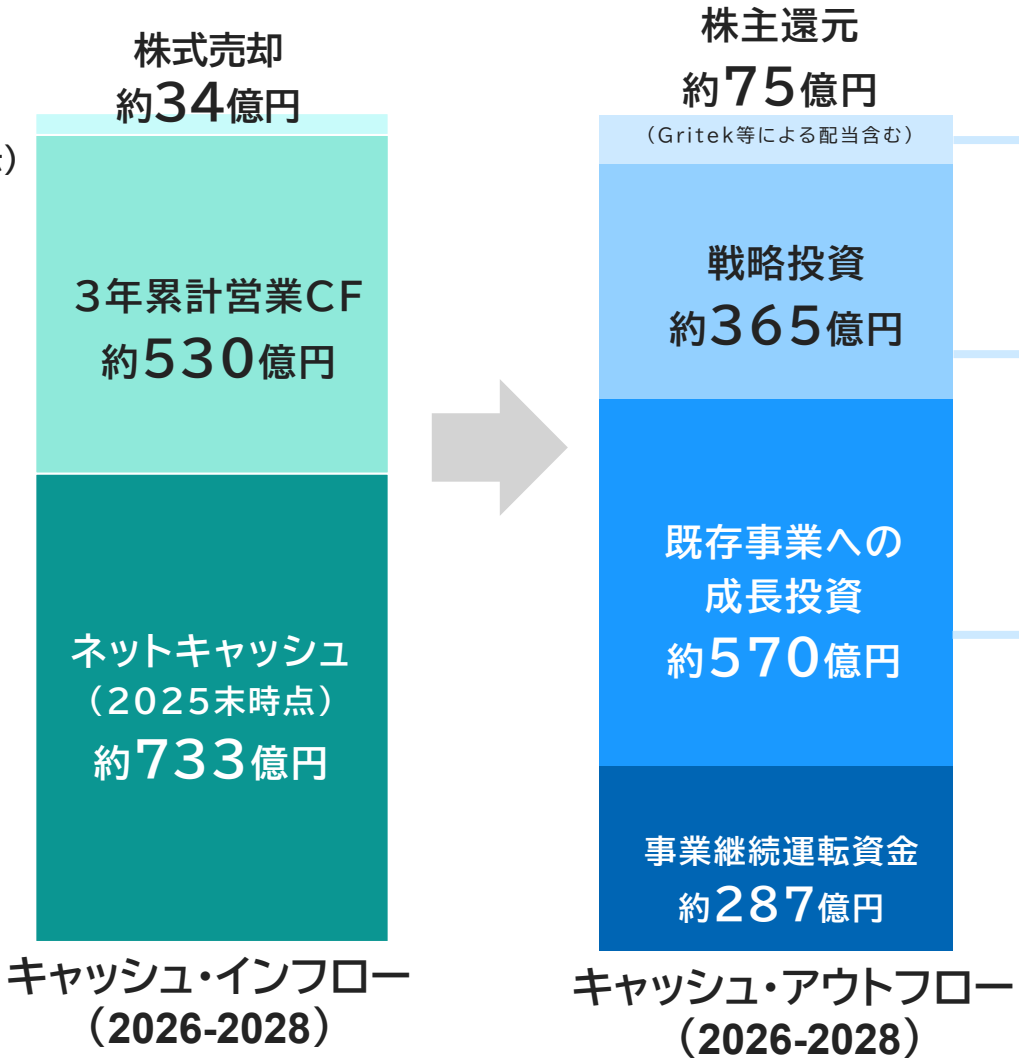
資本収益性向上に向けた取組み （キャッシュ・アロケーション）

- 高収益事業であるウェーハ再生事業への成長投資を加速させ、営業CFの最大化を図る

中国子会社Gritekの株式一部を売却（2026年2月10日開示）

再生ウェーハの生産能力拡充による収益拡大を主に、営業CFの最大化を図る

キャッシュを有効活用し、積極的な投資を実施



安定的かつ継続的な株主還元

- 継続的な増配と配当性向の向上

M&Aの活用による事業成長の加速

- 半導体関連領域を中心に当社とのシナジー創出が可能な事業の取り込み
- 海外新規マーケット（欧米、東南アジア等）への進出
- 新規事業投資

高収益事業（再生ウェーハ）への積極投資

- 再生ウェーハ工場設備投資（日本・台湾・中国）：約405億円
- 再生ウェーハ最先端用途向け研究開発：約27億円

- 8インチプライムウェーハ設備投資：約38億円
- 自家消費型太陽光発電設備投資：約40億円
- エネルギー事業への設備投資：約60億円

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

資本収益性向上に向けた取組み (再生ウェーハへの大規模投資)

・3か年で、高収益事業であるウェーハ再生事業への投資を加速させ、さらなる市場シェア及び収益拡大を図る
・三本木第7工場稼働、台南第2工場取得により、2028年までに累計生産能力を月産約120万枚まで拡充予定

■三本木工場

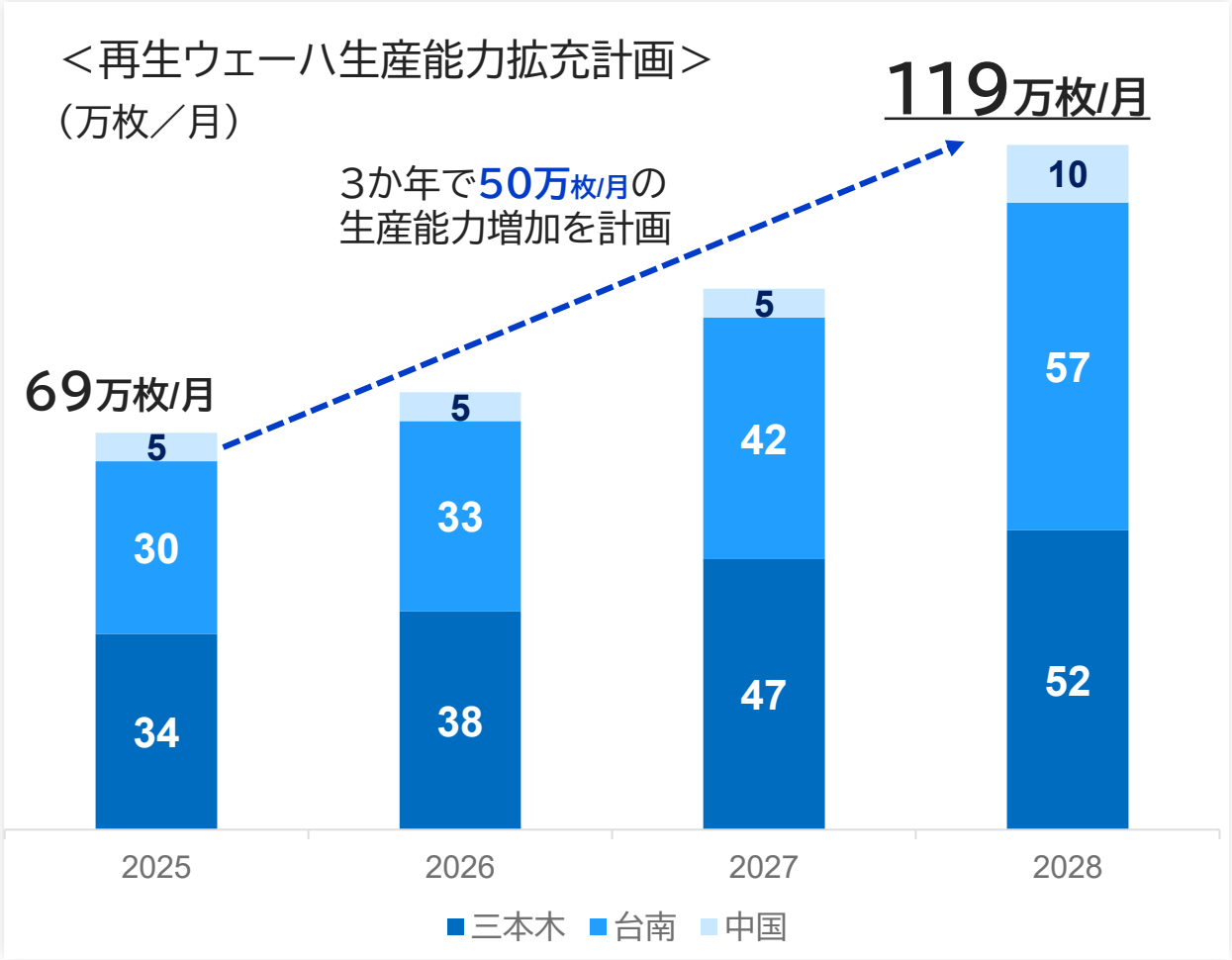
・2028年までに、第8工場は月産35万枚、
第7工場は月産17万枚、計52万枚の量産体制を構築予定
・自動化の推進により、生産効率向上を計画
・最先端設備を導入し、幅広いニーズに対応予定

■台南工場

・2028年までに、第1工場は月産37万枚、
第2工場は月産20万枚、計57万枚の量産体制を構築予定
・第2工場は、2030年までに最大キャパである月産30万枚体制を構築予定

■中国工場

2028年までに月産10万枚体制を構築予定



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

設備投資計画：ウェーハ再生事業

- 2028年までに日本、台湾、中国の3拠点で世界の半導体需要を取り込むべく大規模投資を実施
- 月産119万枚の生産能力を確立し、さらなるシェア拡大を図る

日本

総投資額 **173億円+**

投資額		
2026年度	2027年度	2028年度
119億円	**54億円**	**未定**

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

	2026	2027	2028
第8工場	34万枚	35万枚	35万枚
第7工場	4万枚	12万枚	17万枚
計	**38万枚**	**47万枚**	**52万枚**

台湾

総投資額 **247億円**

投資額		
2026年度	2027年度	2028年度
28億円	**124億円**	**95億円**

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

	2026	2027	2028
第1工場	33万枚	37万枚	37万枚
第2工場	-	5万枚	20万枚
計	**33万枚**	**42万枚**	**57万枚**

中国

総投資額 **100億円**

投資額		
2026年度	2027年度	2028年度
_	_	**100億円**

■ 12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

	2026	2027	2028
中国工場	5万枚	5万枚	10万枚
計	5万枚	5万枚	10万枚

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

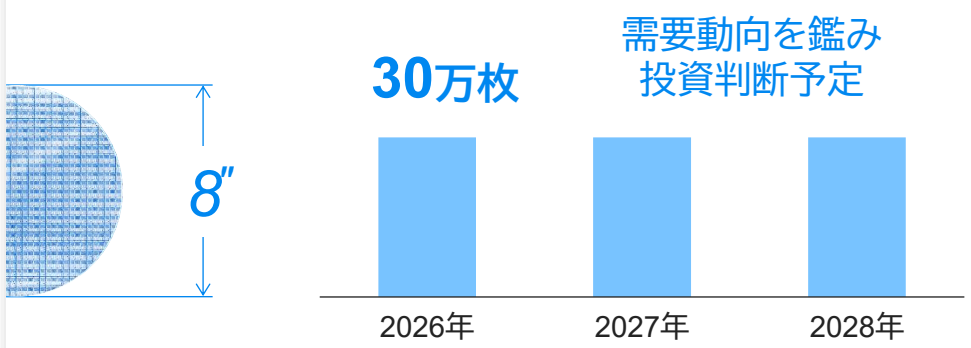
設備投資計画：プライムウェーハ事業

- 8インチプライムウェーハは、2026年中に30万枚/月の生産能力確立。2027年以降の投資は需要動向を見極め判断
- 12インチプライムウェーハは、2028年中に25万枚/月の生産能力確立し、中国プライムウェーハ市場に本格参入予定

中国 8インチ

- 2026年に30万枚/月の体制確立後は、需要動向を見極めた上で投資判断する予定

8インチプライムウェーハ生産能力（月産）

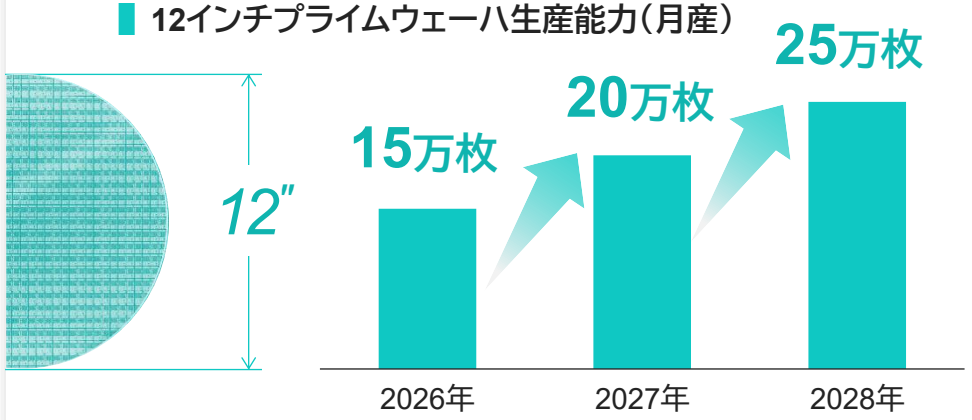


投資額		
2026年	2027年	2028年
38億円	未定	未定

中国 12インチ

- 段階的に12インチプライムウェーハの生産能力増強を実施

12インチプライムウェーハ生産能力（月産）



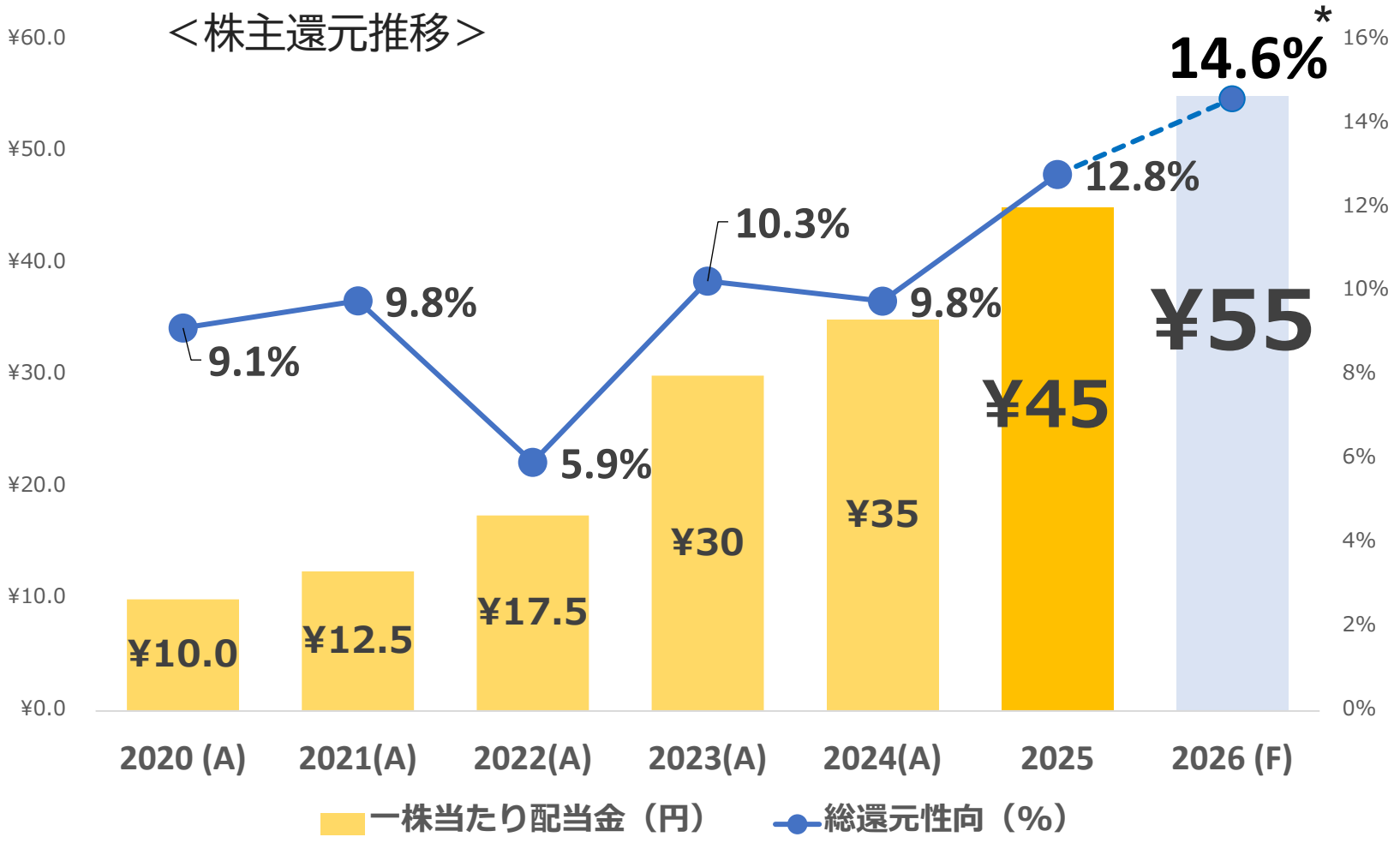
投資額		
2026年	2027年	2028年
100億円※1	220億円※1	120億円※1

※1　12インチ事業は持分法適用会社SGRSからの投資となります。

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

資本収益性向上に向けた取組み（株主還元）

・2025年度の一株当たり配当額は、前期35円から10円増配の45円/株（配当性向12.8%）
・2026年度の一株当たり配当金は、55円を想定



・毎期の増配に加えて、
2025年は増配額を
前期の5円増から10円増とする

・2026年も前年比10円増を計画し、
総還元性向の引き上げを意識する

* 14.6%は現時点における予測値

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

資本収益性向上に向けた取り組み（IR活動状況）

・今後も企業価値向上につながるIR活動を推進予定

◆ 役員のIR活動への関与

・IR部門による面談に加え、経営方針や戦略についてより理解を深めていただくため、
役員自ら投資家様と対話する機会を積極的に設定



◆ 海外IRの強化

・海外投資家からの面談数の増加に伴い、海外IRも強化
（2024年は欧州のノンディールロードショーを実施）

・決算・適時開示情報の英文同時開示や英文サイトの充実化により、
国内、海外の情報非対称性解消に向けた取組みを強化

◆ 個人投資家へのアプローチ

・個人投資家へのプレゼンス拡大に向けて、IRフェアやセミナー等、イベントに積極参加

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

RS Technologies
の目指す世界

一歩一歩、着実に事業領域および
販売地域を広げていく

事業 → 成長拡大

地域 →

			日本	中国	アジア（中国以外）	欧米
製造	ウェーハ再生		●	●	●	●
	プライムウェーハ	12in	○	●	○	○
		8in他	◎	●	◎	◎
	半導体製造関連消耗財		●	●	●	●
	半導体製造		○	○	○	○
エネルギー事業	新規		○	○	○	○
	バナジウムレドックスフローバッテリー		●	◎	◎	◎
商社機能	製造装置		●	●	●	●
	半導体・電子部品・消耗財		●	●	●	◎
	その他（太陽光など）		●	○	●	○

● 現事業領域　◎ 地域拡大予定　○ 今後進出の可能性有

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

M&Aターゲット

・事業規模拡大に向け、M&Aを実施

・「半導体」、「エネルギー」、「新規事業」がM&Aのターゲット

＜M&Aターゲット領域＞

半導体

RS Technologies

DGtec

UNION Electronics Solutions

エネルギー

LE System

新規事業

RSPDH

＜投資判断基準＞

◆投資基準（ハードルレート）≒利回り14～20%

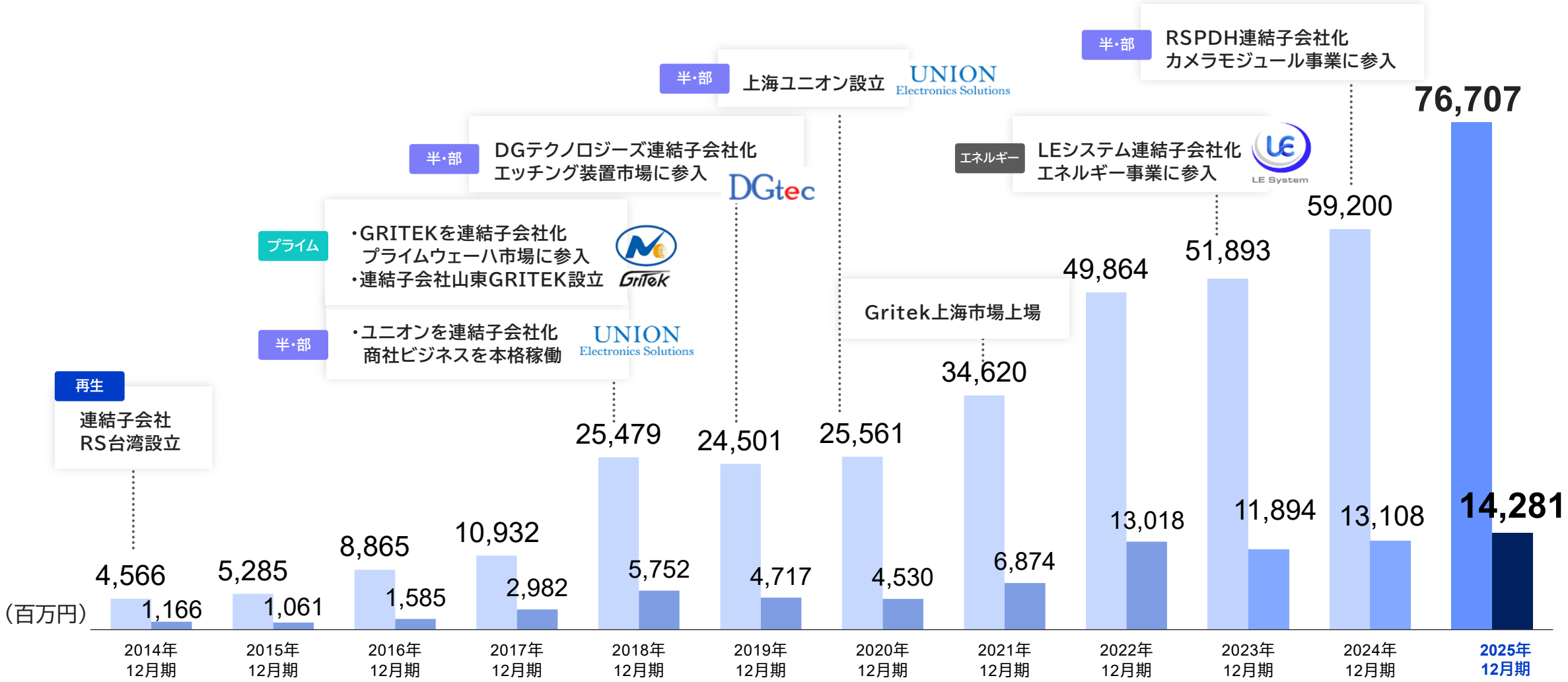
◆シナジー効果を重視したターゲット選定

◆新規事業において成長性のある市場の選定

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

M＆A実績と売上高推移

・積極的なM＆Aを中心とした成長戦略により、CAGR売上高29.2%、営業利益27.4%を達成



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

会社概要

03

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

会社概要

- ウェーハ再生事業で世界市場シェア31%のトップ企業※1
- 中国中央企業※2との合弁事業でプライムウェーハ事業に進出
- M&Aによりシナジーの期待できる周辺事業領域に事業を拡大

社　　名	株式会社RS Technologies
設　　立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	・シリコンウェーハの再生加工・販売 ・プライムウェーハの製造・販売 ・半導体製造装置向け消耗部材の製造・販売 ・超音波映像装置・電子部品の販売 ・エネルギー関連事業 ・カメラモジュールの製造・販売　等
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1　NTビル
製造拠点	宮城県、茨城県、福島県、台湾、中国
資本金	5,860百万円（2025年12月末時点）
代表取締役	方　永義

※1　SEMIデータに基づき弊社にて推計
※2　国有企業のうち、中央政府の管理監督を受ける企業
※3　2026年6月末現在

主な連結子会社

有研半導体硅材料股份公司（GRITEK）	登録資本	1,250百万人民元
	出資比率	39.1%※3
	上場	上海証券取引所科創板
艾爾斯半導体股份有限公司（RS台湾）	資本金	NT $300 million
	出資比率	100%
株式会社 DG Technologies	資本金	100百万円
	出資比率	57.4% ※3
株式会社 ユニオンエレクトロニクスソリューション	資本金	27百万円
	出資比率	100%
株式会社LEシステム	資本金	30百万円
	出資比率	100%
艾索精密部件（惠州）有限公司	資本金	555百万人民元
	出資比率	100%

CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

沿革

- 設立以来、ウェーハ再生事業における世界トップ企業として確固たる地位を確立、
  2018年に中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化したことで、ウェーハ総合メーカーに

2010年 12月	ウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社RS Technologiesを設立	再生
2014年　2月	台湾に艾爾斯半導體股份有限公司（連結子会社）を設立	再生
2015年　3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場	
2016年　9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更	
2018年　1月	中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司（GRITEK）を連結子会社化	プライム
2018年　5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得	半・部
2018年　8月	山東有研半導体材料有限公司（GRITEKの連結子会社　山東GRITEK）を設立	プライム
2019年　1月	株式会社DG Technologies（DG）の100%株式を取得	半・部
2020年　2月	上海悠年半導体有限公司（上海ユニオン）を設立	半・部
2022年　4月	東証一部からプライム市場へ移行、指名報酬委員会（任意）を設置	
2022年 11月	GRITEKが上海証券取引所科創板市場へ上場	プライム
2023年 12月	「VRFB用の電解液製造事業を展開するLEシステムを連結子会社化	エネルギー
2024年 11月	中国厦門市に艾斯科技（厦门）有限公司（現 連結子会社）を設立	
2024年 12月	光学モジュール・車載カメラモジュール事業を展開する艾索精密部件（惠州）有限公司を連結子会社化	半・部
2025年　6月	艾斯能源（山東）有限公司（現 連結子会社）を設立	エネルギー
2025年 10月	艾斯能源科技（攀枝花）有限公司（現 連結子会社）を設立	エネルギー

再生　ウェーハ再生事業関連

プライム　プライムウェーハ事業関連

半・部　半導体関連装置・部材等事業

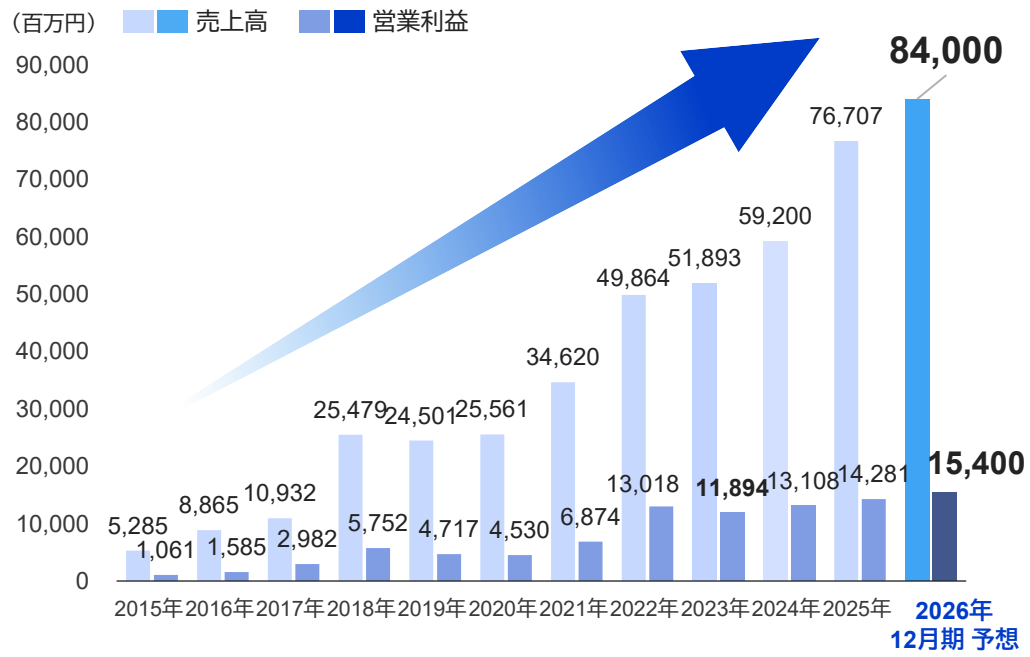
エネルギー　エネルギー関連

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

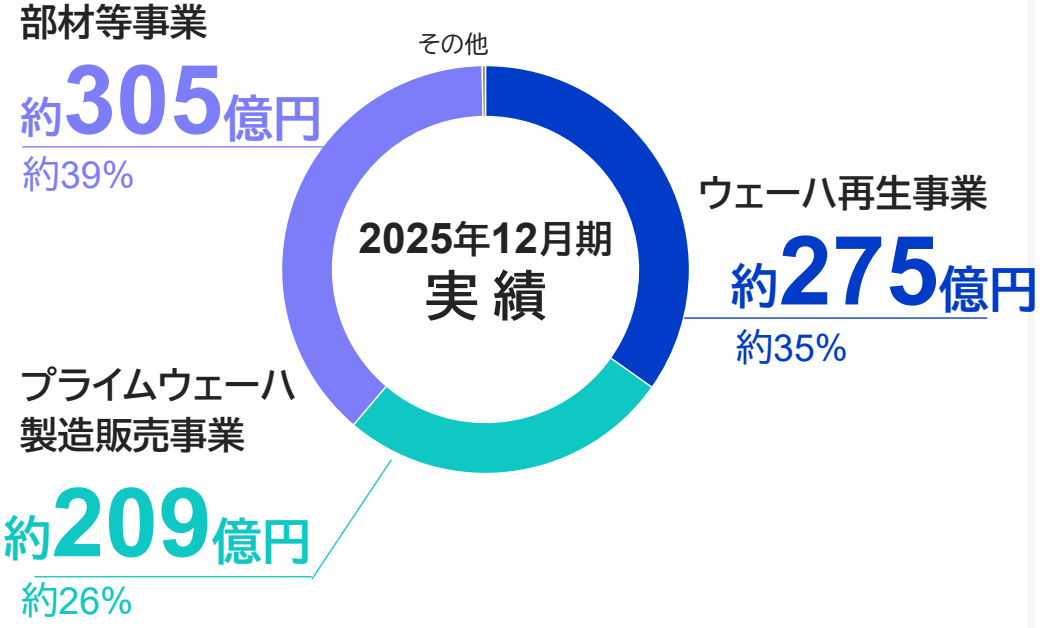
現在のRS Technologies

- ウェーハ再生事業＋プライムウェーハ事業の総合ウェーハメーカー
- 半導体関連装置・部材等事業など事業領域を拡大
- ウェーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウェーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開

連結売上高および営業利益



セグメント別売上高



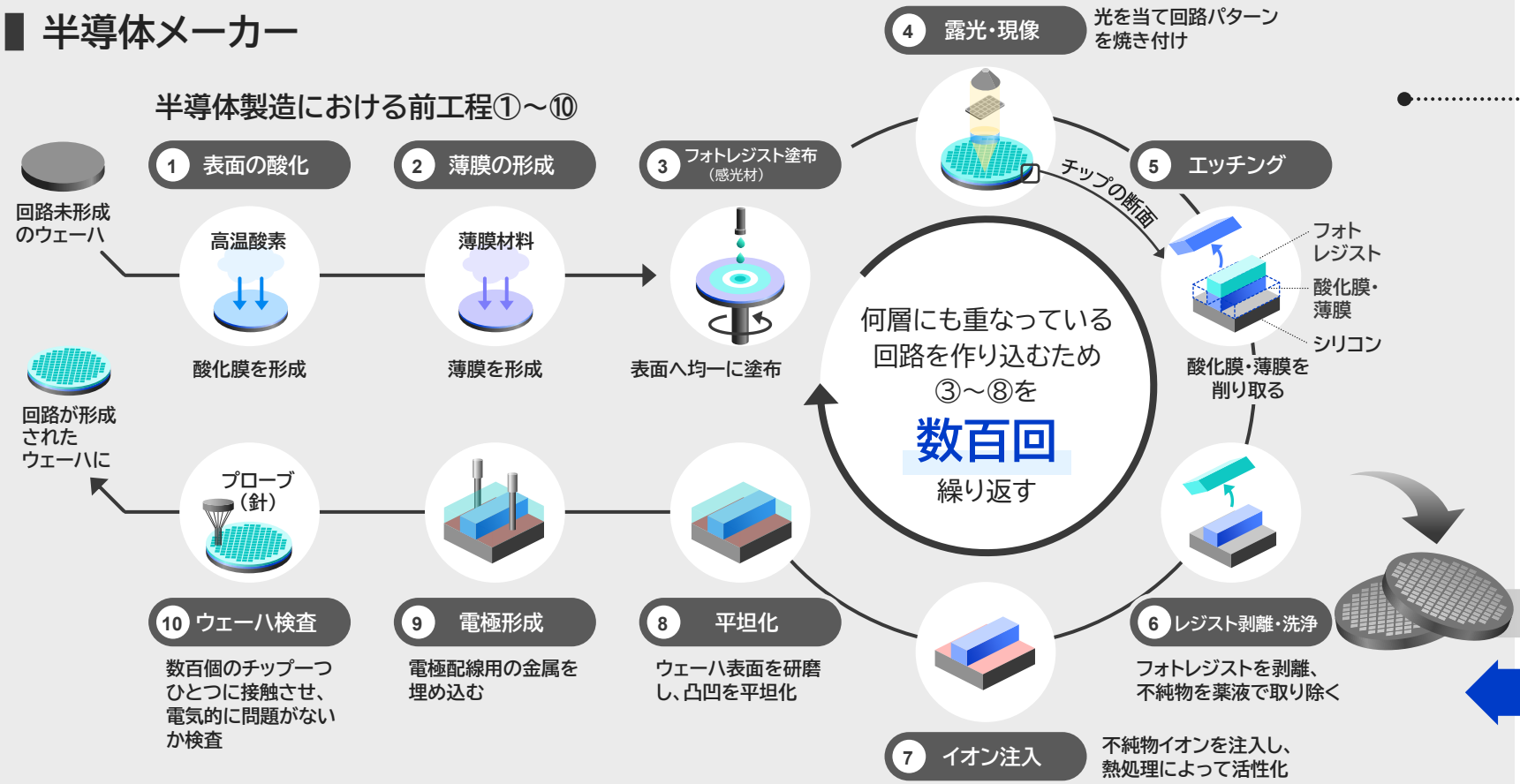
COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

再生ウェーハとは

- 再生ウェーハとは、主に半導体製造において使用されるテストウェーハを再生加工したウェーハのこと
- 再生したウェーハは繰り返し使用されるが、当社独自技術では、10回以上のリサイクルも可能であり、**環境負荷軽減**に加え、半導体メーカーの**コストダウン**にも貢献

半導体メーカー

半導体製造における前工程①～⑩



当社

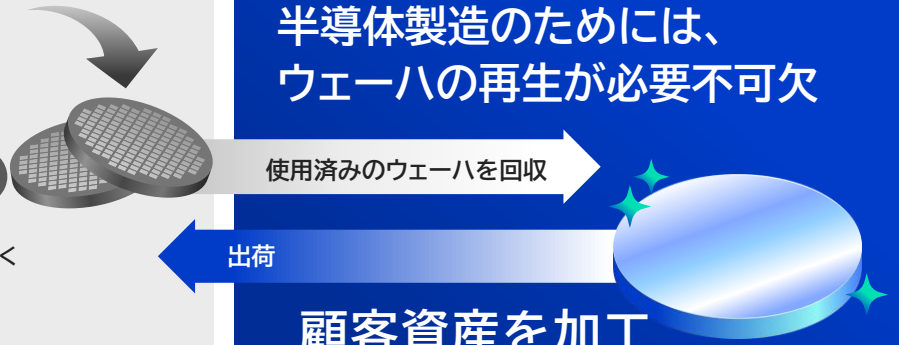
ほぼ全ての工程で使用される

- モニターウェーハ（用途：プロセスや加工精度の評価）
- ダミーウェーハ（用途：精密加工の安定性向上）

当社はそれらを再生し、半導体メーカーへお戻ししている

再生加工（再利用できる状態にクリーニング）

半導体製造のためには、ウェーハの再生が必要不可欠



顧客資産を加工

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

ウェーハ再生事業について

- 再生ウェーハ業界におけるグローバルサプライヤーとして、継続的な業績拡大を実現

市場の特徴

半導体業界の継続的な成長

世界の半導体市場規模は、2025年から2030年にかけてCAGR：約8%で成長し、2029年には**1兆米ドル**に達すると予測されている※1

※1出所：SEMIジャパン

景気変動に強い

- 製造装置の立上げ等多用途に利用される
- 不況時に顧客のコスト意識が高まると、再生ウェーハ投入量が増える

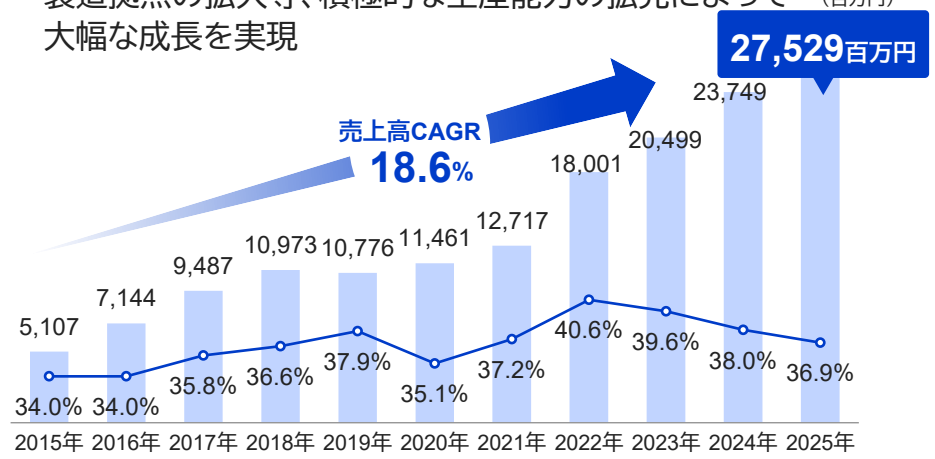
シリコンサイクルの影響を受けにくい

今後も継続的な成長が見込める

実績

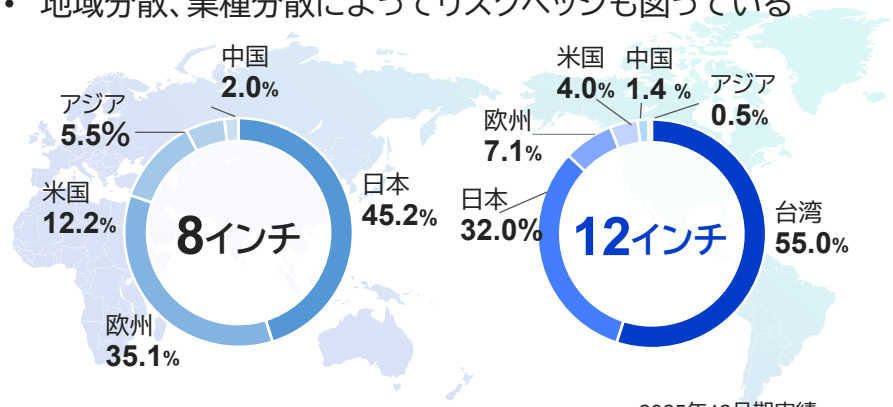
業績推移

- 製造拠点の拡大等、積極的な生産能力の拡充によって大幅な成長を実現



地域別出荷構成

- 日本・台湾・欧州・北米と幅広い出荷先を確保
- 地域分散、業種分散によってリスクヘッジも図っている



2025年12月期実績

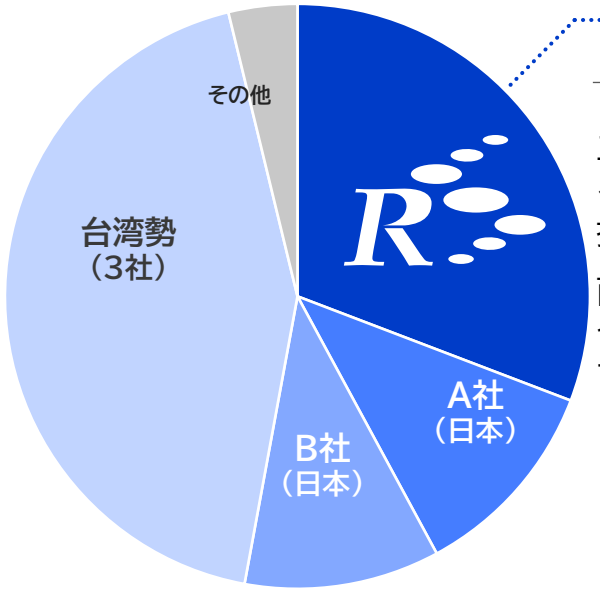
COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

再生市場における当社のシェア

再生市場での当社のシェア拡大

■ 12インチ再生市場における当社シェア

グローバルシェア No.1 (約31%)



RS Technologies

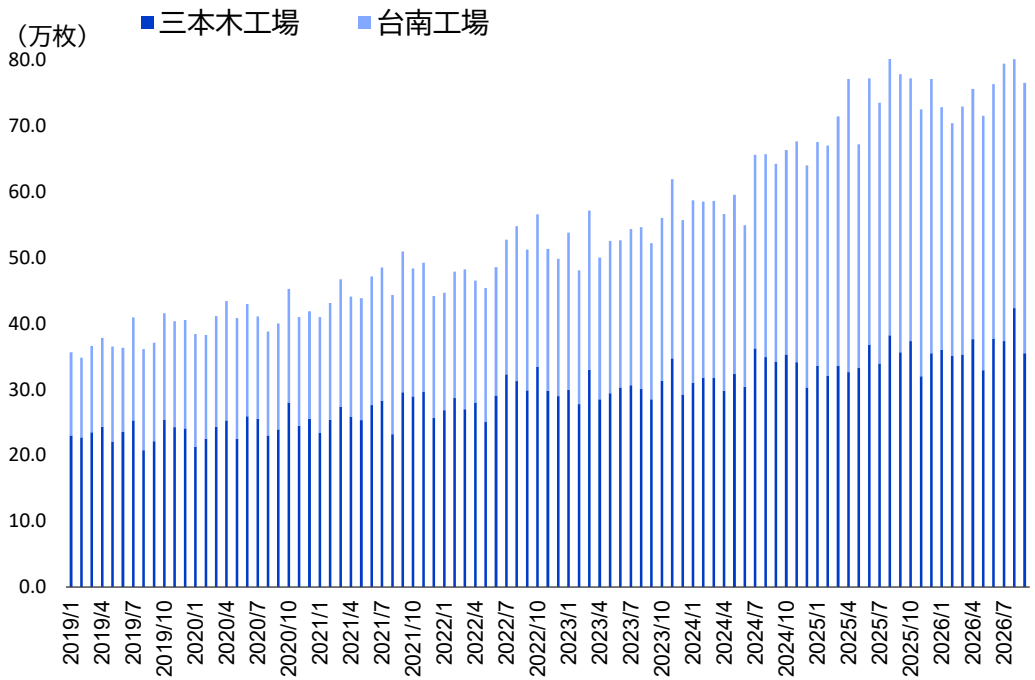
三本木、台南工場の設備投資による生産能力の拡大に伴いシェアが拡大

両工場のさらなる生産能力の増加や業務提携・M&A等の手法を用いて、シェアアップを目指す

SEMIデータに基づき弊社にて推計

三本木工場と台南工場の出荷推移

■ 三本木工場と台南工場の12インチウェーハ出荷枚数推移



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

当社再生の強み

クリーンルーム

- 顧客フォローアップ
- 入荷
- 受け入れ検査
- ストリッピング/エッチング
- プレソート検査
- ポリッシング
- 1次洗浄(1次検査)
- 2次洗浄
- 最終検査/包装
- 出荷

強み 01 直販体制による正確なニーズの把握

全ての顧客と直接コミュニケーションを行い、
東京本社で管理することにより圧倒的なコストダウンを実現

強み 02 すべての膜を剥離可能

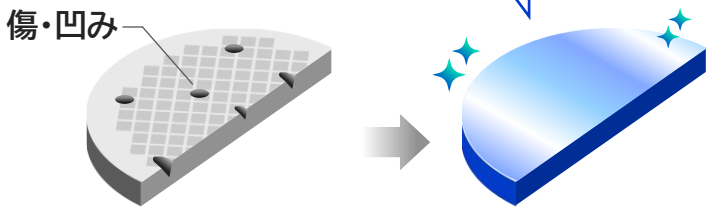
ケミカル処理の為、表面のダメージが最小限に

再生回数が多い

▼

よりコストダウンが可能

ラサ工業(化学)の
独自技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨(ポリッシング)により平滑にする

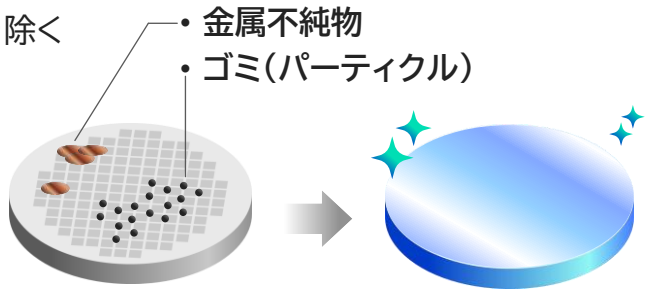
強み 03 金属不純物を除去

ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く

＋

金属不純物を除去

特に銅(Cu)の除染除去に強み



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

ウェーハ再生事業の需要先：12インチ半導体“新”工場

- 世界市場では、中欧米日等で12インチ半導体新工場建設プロジェクトが進行中
- 当社は、日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応



注：RST調べ

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

売上高構成

- セグメント内再生ウェーハ、販売ウェーハの割合は、7:3程度が継続

収益構造

ウェーハ再生事業　売上高

再生加工賃収入

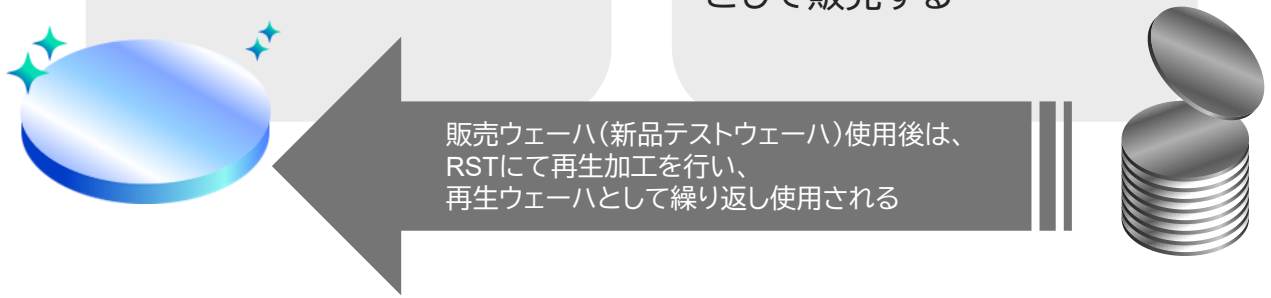
（加工単価×出荷枚数）

半導体工場から使用済みテストウェーハをお預かりし、クリーニング（再生加工）を行い、同じ工場にお戻しする

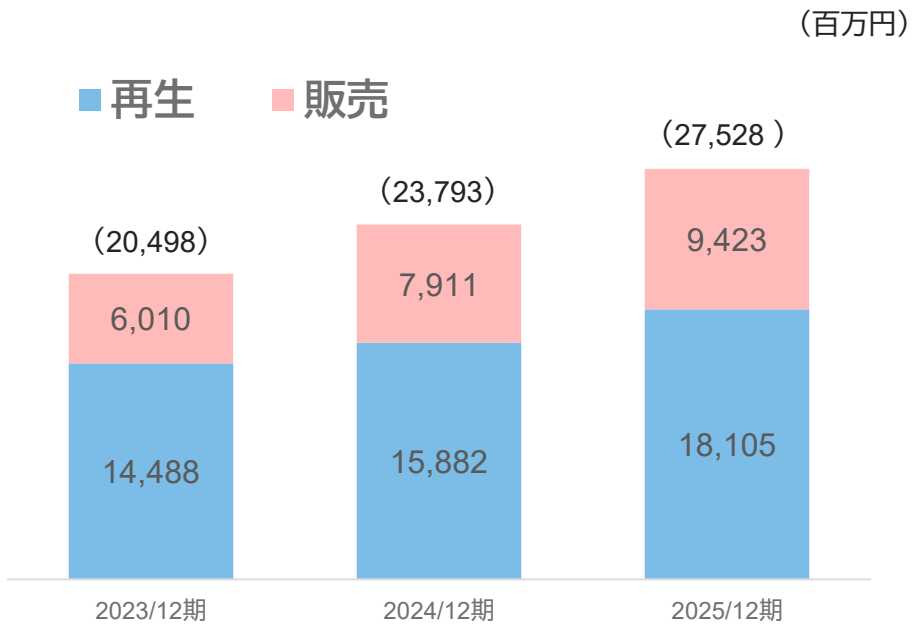
販売ウェーハ売上高

（販売単価×販売枚数）

市場よりスペックアウトしたテストウェーハを買取り、RSにて磨き上げ、需要のある半導体工場に新品テストウェーハとして販売する



売上高内訳



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

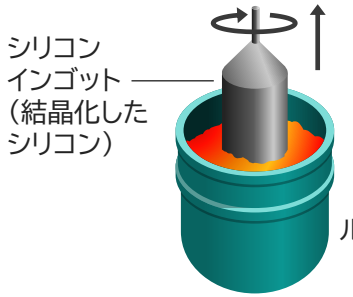
プライムウェーハとは

- プライムウェーハとは、半導体の基板材料であるシリコンウェーハのこと
- イレブンナイン（純度99.999999999%）のシリコンを用いており、非常に高い平坦度のウェーハに加工する事業

製造工程

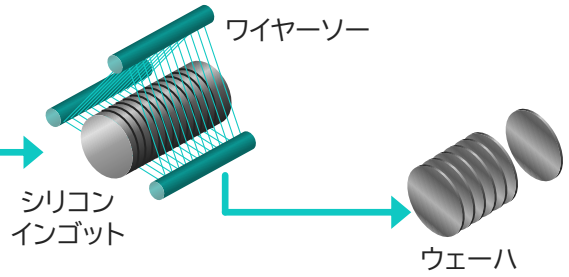
①シリコンインゴット引上げ

ルツボの中で結晶化させた
シリコンを回転させながら引上げ



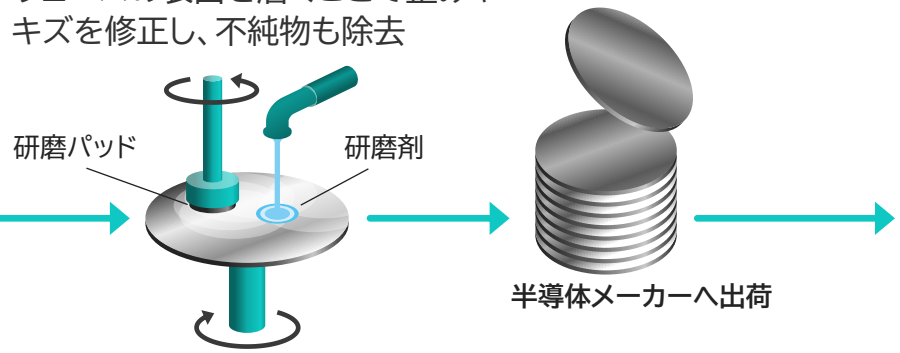
②シリコンインゴット切断

ワイヤーソーを使用してスライスし、
円盤形のウェーハに切り出し



③ウェーハの研磨

ウェーハの表面を磨くことで歪みや
キズを修正し、不純物も除去



ポイント

配合や温度、引上げスピード等を
制御することで、いかに**高純度で
欠陥のない単結晶**を製造できるか

1本の単結晶からいかに多くの
高品質なウェーハを得ることが
できるか

高度な加工工程を経ることで、
いかに**超平坦・超清浄なウェーハ**
に仕上げられるか

全ての工程において、非常に高い結晶技術や研磨技術が求められる

マーケット

シリコンウェーハの市場は2兆円を超える規模であり、今後さらに規模拡大が進む

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

プライムウェーハビジネスへの進出について

・中国中央企業※1の有研科技集団有限公司（GRINM）と事業会社である有研半導体材料有限公司※2（GRITEK）を設立

※1 国有企業のうち、中央政府の管理監督を受ける企業
※2 現：有研半導体硅材料股份公司

クリーンルーム

- インゴット引上
- スライシング
- ラッピング
- エッチング
- ポリッシング
- 1次洗浄（1次検査）
- 2次洗浄
- 最終検査/包装
- 出荷

当社とGRINMとのシナジー効果

強み 01 GRITEKの持つ技術力



強み 02 中国半導体施策の恩恵を享受

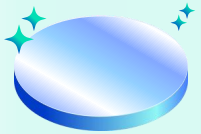


強み 03 RSのグローバルな販売網で全世界顧客へ販売



強み 04 RSの再生加工技術を活用

30年以上に及び当社の知見・見識あり



有研科技集団有限公司（GRINM）

1952年創立：中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関
約4,100名の従業員のうち、約2,000人の研究者が在籍

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

当社のプライムウェーハ事業

- 2018年、中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関である有研科技集団有限公司（GRINM）と合弁し、有研半導体材料有限公司※1（GRITEK）を連結子会社とすることにより参入。中国山東省にフラッグシップ工場を竣工
- GRITEKは2022 年、上海証券取引所科創板市場に上場した

Gritekの強み

高い技術力

GRINMとの協業によって中国トップレベルの高品質を実現

コア事業とのビジネスシナジー

最終工程である研磨・洗浄・検査において、再生ウェーハ事業で培ったノウハウを流用

市場優位性

GRINMグループの商流を活用することで、中国国内での販売における優位性を獲得

戦略的な市場選択

出荷数の多いボリュームゾーン（ロー～ミドルエンド）に狙いを定めて投資を実行

進捗

グローバル品質の量産ラインを確立 → **8** インチ　月産生産能力が25万枚に到達　**12** インチ

- フラッグシップ工場を竣工
- 徳州市政府系ファンドとの合弁
- 月産11万枚の生産能力

今後の取組み



設備投資によって生産能力を拡充



再生ウェーハ事業の顧客網を活かして販促活動を強化



M&A等の活用によってグローバル市場を目指す

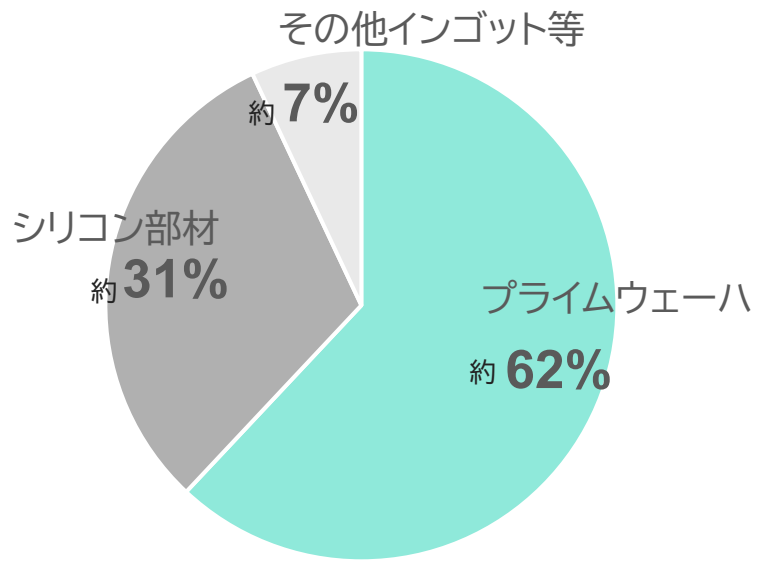
※1 現:有研半導体硅材料股份公司

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

売上高構成

- 中国の徳州工場及び北京工場にて製造したプライムウェーハ、シリコン部材をメイン商材として販売

プライムウェーハ事業売上構成イメージ



（2025年12月期実績）

商品概要

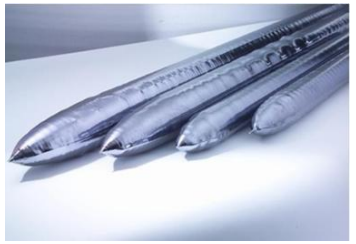
■半導体用プライムウェーハ
5、6、8インチ　プライムウェーハを
中国のEpi HOUSEや半導体メーカーに販売



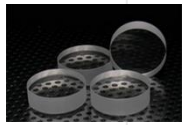
■シリコン部材
エッチング装置の消耗部材に加工されるシリコン部材を
グローバル及び中国の加工メーカーへ販売
（エンドユーザーはエッチング装置メーカーや半導体工場）



■その他インゴット等
FZ等のウェーハ用インゴットの販売、
その他技術コンサルティング等





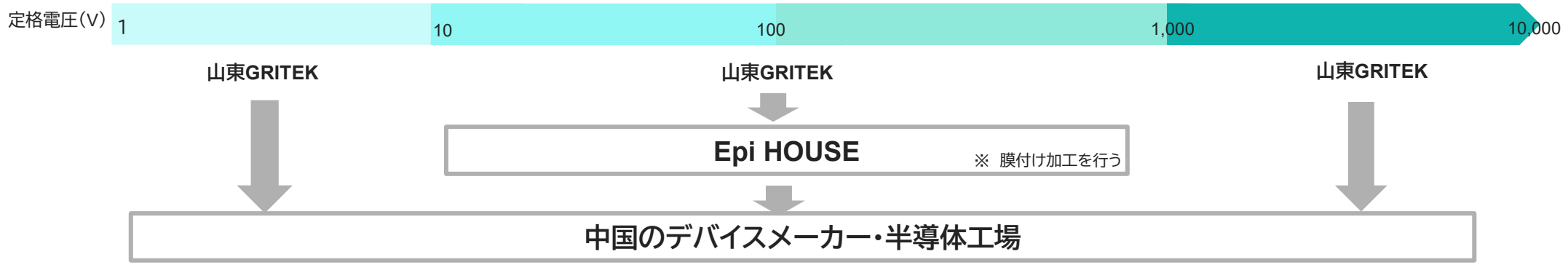


COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

8インチプライムウェーハ商流と売上構成イメージ

- GRITEKは、プライムウェーハ市場の中ではニッチな分野を強みとするため、高い利益率が継続
- 中国政府の経済活性化に向けた取組みの1つである家電購入時の補助金を追い風に、パワー半導体需要は増加傾向

■GRITEK　8インチウェーハの主な商流イメージ



■使用用途イメージ



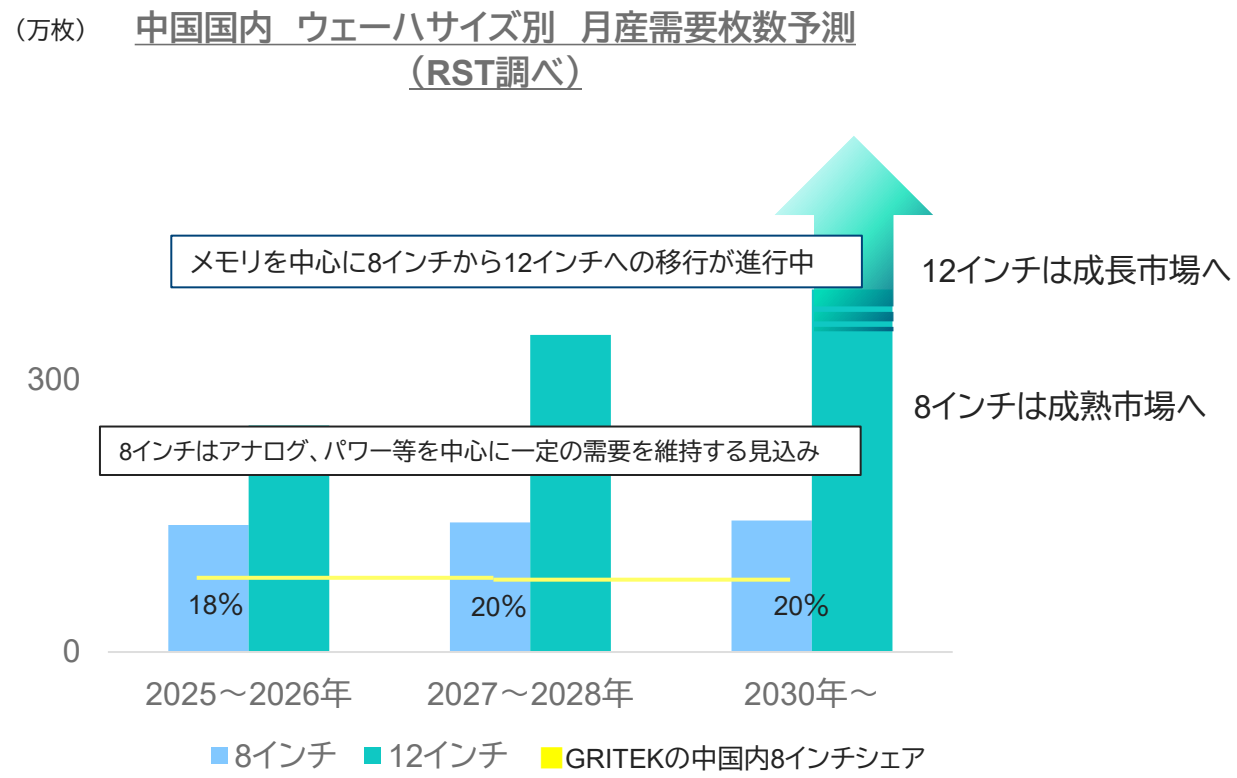
■GRITEK　8インチウェーハの売上高構成イメージ(2025年12月期実績)



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

中国プライムウェーハ戦略（市場予測）

- 8インチの需要枚数は、2028年まで緩やかに増加すると予測
- 12インチ市場は急拡大中であり、2030年の需要枚数は月産400万枚を超えると予測



【2028年までの戦略】

■8インチ
GRITEKの強みである高電圧パワー半導体向けの新製品開発、
増産投資を強化
⇒2027年以降は、中国内シェア20%を目指す

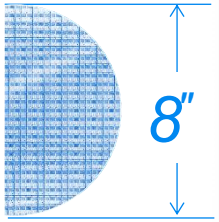
■12インチ
量産体制を構築し、中国国内のプライムウェーハ出荷数を増加させる
⇒中国12インチ市場にてシェア7%を目指す

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

プライムウェーハ事業施策

＜事業施策＞

GRITEK

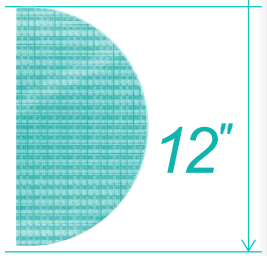


・**計画的な設備投資と高稼働を継続し、中国8インチウェーハ市場のシェアアップを目指す**

・**高付加価値、高単価製品への取り組みを強化**
-競争力の高いパワーデバイス向けウェーハを中心に、顧客と連携した特注品、新製品を開発
-安徽省Epiハウスにて Epi加工生産数を増加させ、パワーデバイス用Epiウェーハの量産・販売を開始
-FZウェーハ・FZウェーハ用インゴットの生産・販売を強化 ※1

※1 FZ法で引き上げたインゴットは、シリコン内部の抵抗率や不純物濃度を高精度にコントロールでき、主に高電圧・高耐圧及び大電流用途の高性能パワーデバイス向けに使用されます。

SGRS



・**GRITEKの技術を転用し、パワーデバイス向け12インチプライムウェーハの販売数量を増加させ、収益力を向上**

・**高付加価値、高単価製品への取り組みを強化**
-安徽省Epiハウスと連携し、パワーデバイス用Epiウェーハの量産・販売を開始
-MCZウェーハの生産・販売を開始 ※2

・**メモリ向けポリッシュドウェーハの顧客認定を進める**

・**GRITEK連結子会社化後は、2029年の月産30万枚体制に向けて、継続的な設備投資を実施**

※2 MCZ法で引き上げたインゴットは、磁場を利用することで酸素濃度や結晶品質を安定的に制御でき、主に高電圧・高耐圧の高性能パワーデバイス向け及びメモリ向けに使用されます。

＜中長期施策＞

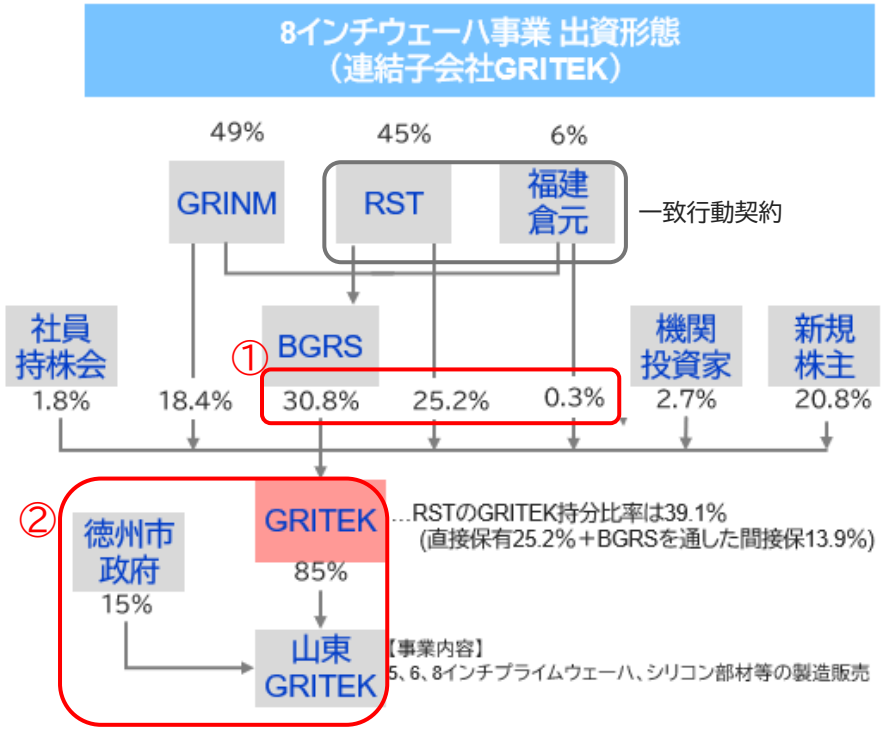
・2028年からは内モンゴルの単結晶工場でも8インチ／12インチのインゴットを製造し、コスト削減による収益性改善を実現

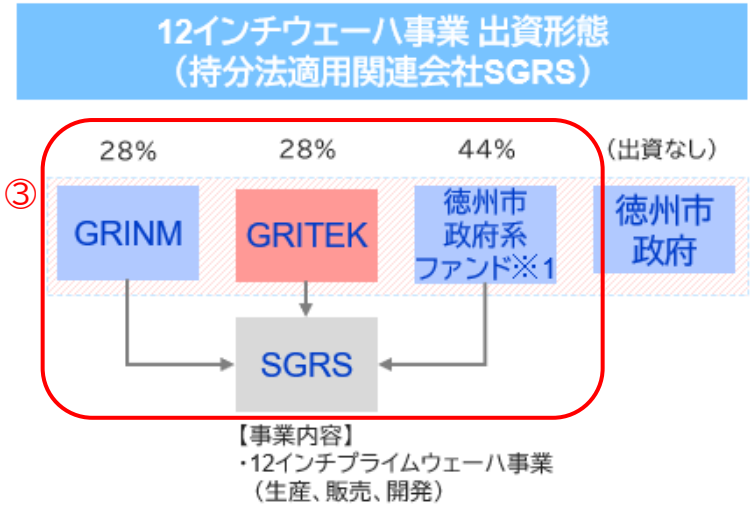
・今後中国内での需要拡大が見込まれるロジック用12インチEpi加工の研究開発を実施し、より付加価値の高いウェーハの生産・販売を実現

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

GRITEKグループ再編計画

- 9/11開示「連結子会社（プライムウェーハ事業）の組織再編に関するお知らせ」のとおり、2027年中を目途に、GRITEKグループの再編を完了予定





（2026年9月末時点スキーム）

①GRITEKが新株を発行し、RSTのGRITEKに対する持分比率が低下した場合も、連結を継続する予定。（現：BGRS＋RST＋福建倉元　計56.3%の支配権を保有）

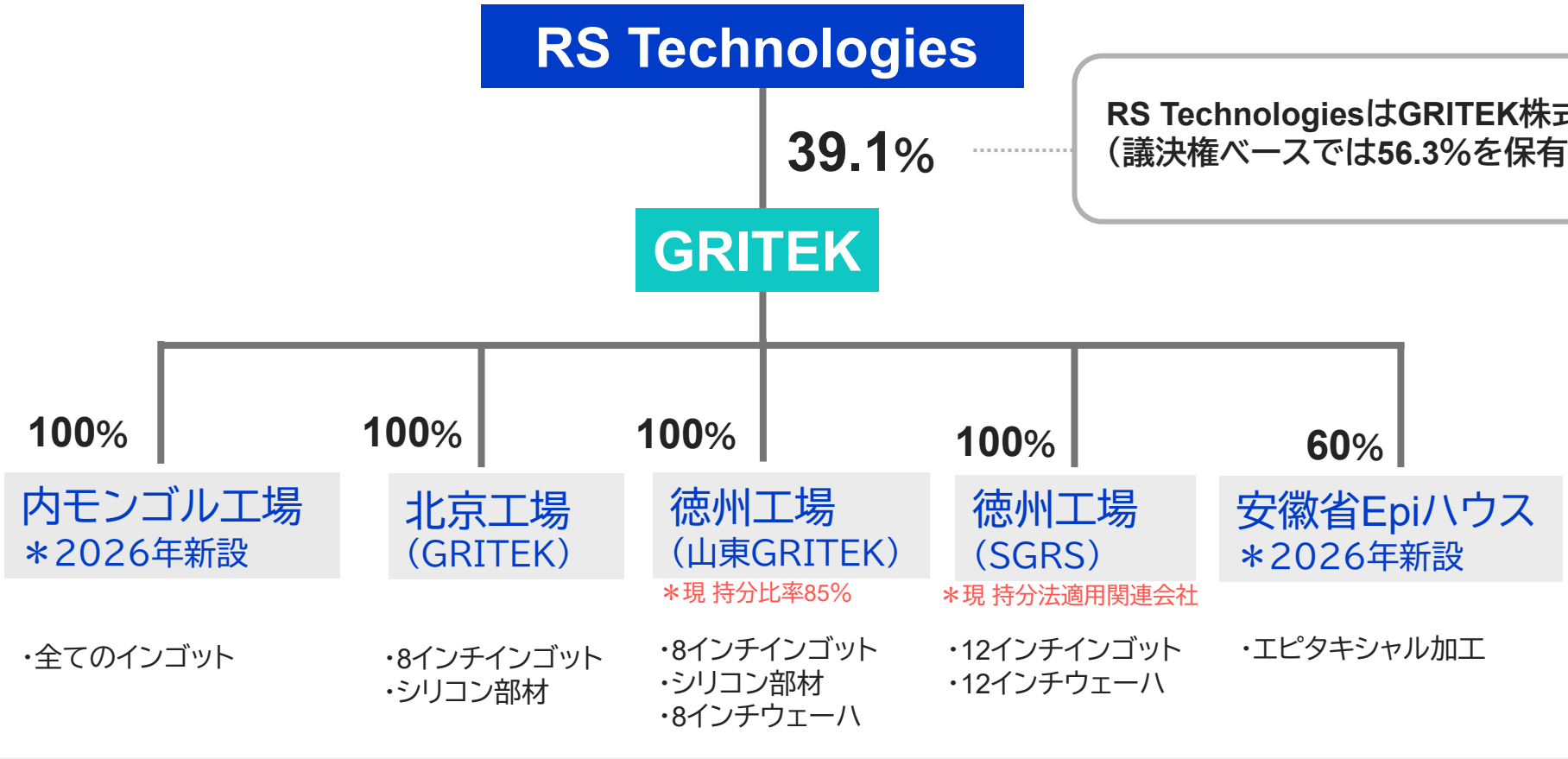
＜8インチウェーハ事業＞
②GRITEKが株式交換により、徳州市政府が保有する山東GRITEK株式15%を取得。**山東GRITEKはGRITEKの100%子会社となる。**
※プライムウェーハ事業の売上高の90%以上を山東GRITEK（徳州工場）が占めるため、100%子会社化により、RSTに帰属する最終損益の取込み割合は増加する。

＜12インチウェーハ事業＞
③GRITEKが株式交換及び現金支払いにより、SGRSの持分をGRINMから28%、徳州市政府系ファンドから44%取得し、**SGRSはGRITEKの100%連結子会社となる。**
※現在はSGRSの損益について、持分法により28%を経常利益に、11%をRSTに帰属する最終利益に反映している。
連結後は、営業損益を100%取り込み、当期純損益はGRITEKの持分比率に応じて取り込む。

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

GRITEKグループ再編計画

- GRITEK再編完了後は、プライムウェーハ事業に係る全ての子会社をGRITEK連結に集約し、サプライチェーン全体を一体的にマネジメント。
- RS Technologiesは引き続きGRITEKの経営権を維持し、グループ全体を統括。



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

半導体関連装置・部材等事業について

・製造販売機能と商社機能を展開するセグメント

	製造・販売機能	商社機能
事業主体	・株式会社DG Technologies（子会社） ・株式会社LEシステム（子会社） ・艾索精密部件（惠州）有限公司（RSPDH）（子会社）	・株式会社 RS Technologies ・株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション（子会社）
概要	・DG Technologies シリコンや石英の精密加工技術を活かした 半導体製造装置向けの消耗部材を製造・販売  ・LEシステム バナジウムレドックスフロー電解液の製造・販売 蓄電事業を初めとしたエネルギーソリューション事業全般  ・艾索精密部件（惠州）有限公司（RSPDH） 光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造・販売 	最新の製品を海外市場に向けて代理販売  レーザーダイオード  超音波映像装置
今後の取組み	グローバルネットワークを活かし販路の拡大 研究開発を継続し製品の優位性を高める **競争力のある製品をグローバル展開していく**	製品ラインナップの拡充 販売エリアの拡張 **売上規模の拡大を図る**

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

エネルギー事業

- **2023年12月、M＆Aによりエネルギー事業に参入、2025年6月には中国にてVRFB用電解液事業を展開するRS能源を設立**

【エネルギー事業のコアミッション】

LE System

●RSテクノロジーズのグループ総合力を活用したトータルエネルギーソリューションカンパニーとなる

●安全性・長寿命に優れたVRFB電解液の安定供給を通じて、持続可能な環境社会実現の一翼を担う

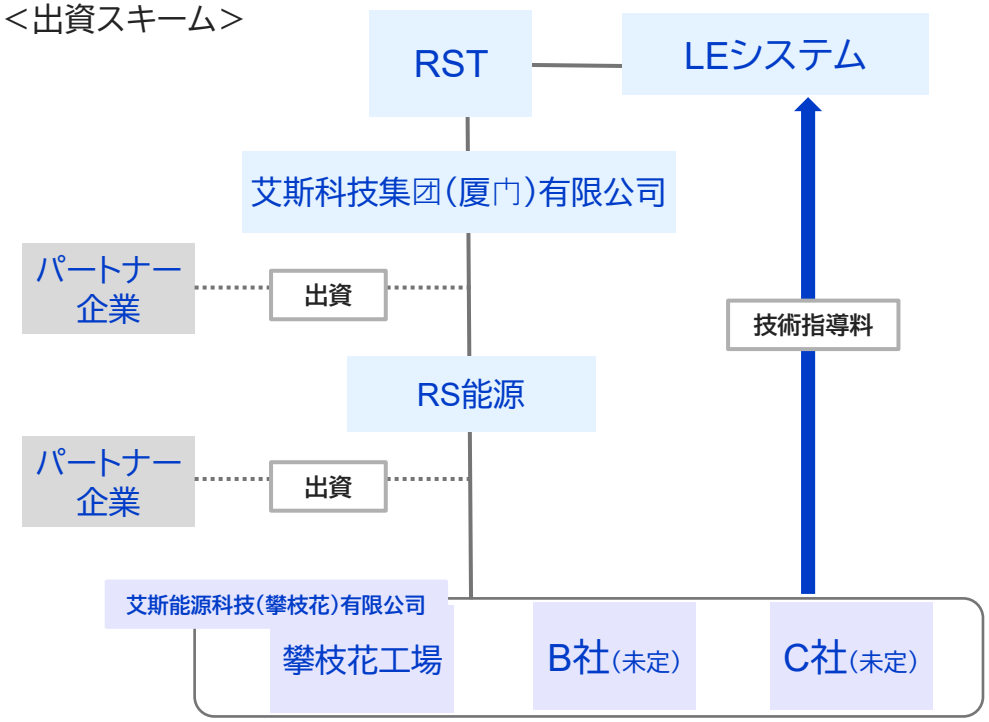
＜会社概要＞

社　　名	株式会社LEシステム／艾斯能源（山東）有限公司（略称：RS能源）
設　　立	2023年10月13日（事業承継日：2023年12月／2025年6月
事 業 内 容	VRFB用電解液、電気料金最適化コンサルティング等
所 在 地	東京都品川区大井1-47-1NTビ （株式会社RS Technologies内）
製 造 拠 点	浪江工場（福島県）、攀枝花工場（中国四川省）※建設中
代 表 者	大澤　一生

（LEシステム）

- 2023年12月より、旧LEシステムの事業を全面的に承継
- 旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた

＜出資スキーム＞



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

エネルギー事業　中長期の展望

・2026年の事業開発段階を経て、中長期的にはトータルエネルギーソリューション企業として、
グループの中核を担う事業に発展させるため中長期戦略を推進中

事業領域		第1フェーズ2023～	第2フェーズ2026年～	第3フェーズ2029年～
VRFB用電解液	VRFB用電解液	【中核事業の確立】 VRFB用電解液の製造販売　自社製造（浪江、攀枝花他）		
VRFB全般	VRFBシステム		【事業拡大】 電解液／蓄電商材販売 ・VRFBシステム（セル）卸販売 ・蓄電製品卸販売 ・電解液用材料製造販売	
エネルギー関連	エネルギー商社			
	蓄電開発			
エネルギー ソリューション	アグリゲーター			【長期戦略】 蓄電総合ソリューション 蓄電所運営
	蓄電池ソリューション			

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

エネルギー事業　バナジウムレドックスフロー電池とは

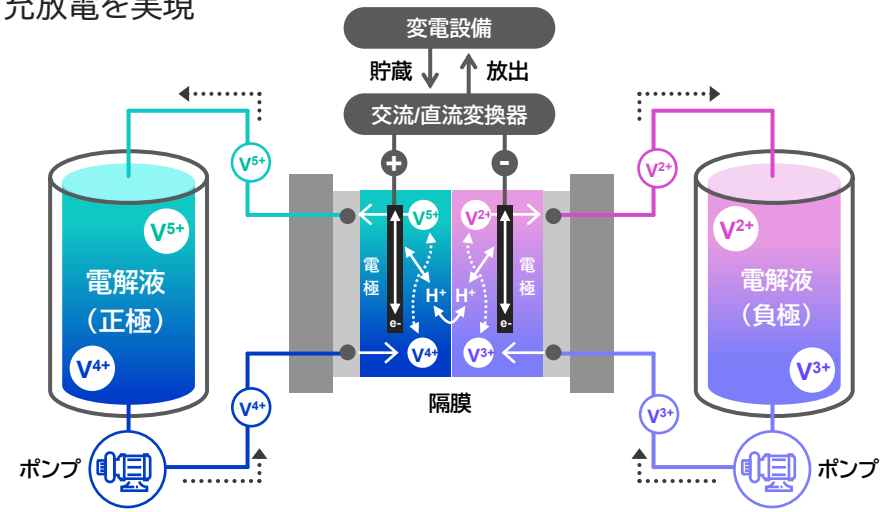
- VRFB（バナジウムレドックスフロー電池）は、バナジウムを用いた電解液を循環・化学反応させることで充電と放電を行う蓄電池
- LEシステムでは、このVRFB用電解液を製造・供給している

主要用途

風力発電や太陽光発電等、大規模・大容量の定置式蓄電池としての活用

仕組み

他の蓄電池が電極の化学変化で充電と放電を行うのに対し、ウォーターバッテリー用電解液の化学変化（酸化還元）による充放電を実現



特 徴

充電と放電回数に制限がなく劣化がないことから長期の安定稼働が可能であり、安全性も高く、再生エネルギーとの相性も良い



VRFBは大容量の定置式蓄電池として高い安全性と安定供給が求められる風力・太陽光発電等に最適な特徴を有する

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

エネルギー事業　国内市場動向

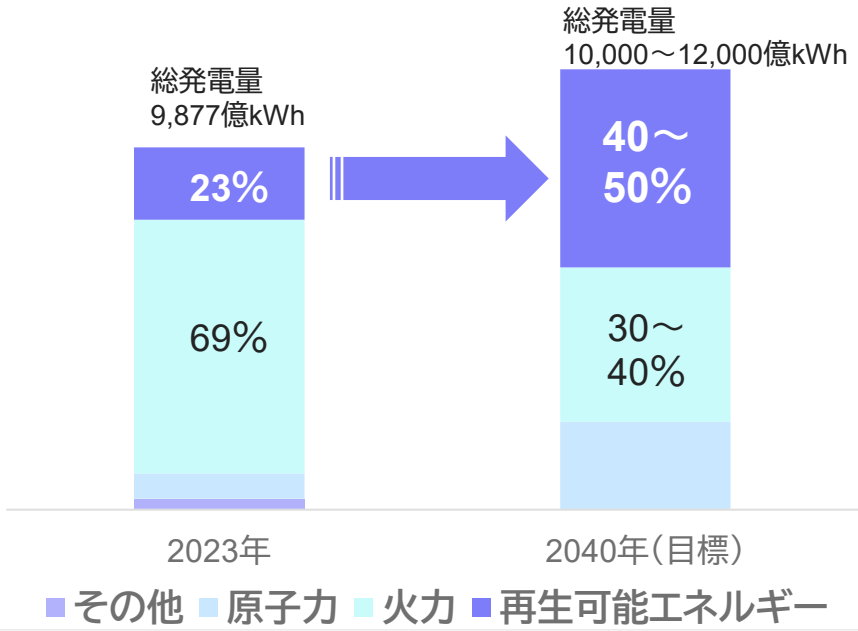
- 2025年2月18日経済産業省が決定した「GX2040ビジョン」達成に向けて、LEシステムではVRFBの社会実装に向けた取り組みを継続

～GX2040ビジョンとは～

GX2040ビジョンとは、日本が2040年までに脱炭素社会を実現し、持続可能な経済成長を目指すための戦略的ビジョンです。
第7次エネルギー基本計画である“2040年度の温室効果ガス73%削減（2013年度比）に向け、再生可能エネルギーを40～50%程度として初の「最大電源」に位置づける”ための具体的な実施計画です。

【日本のエネルギー構成】

再生可能エネルギーは、**2023年から約3,200億kwh増加**見込み
＝**安定供給のため蓄電池の需要が拡大**



出所：資源エネルギー庁「エネルギー基本計画の概要

【エネルギー政策の大原則“S＋3E”】

安全性（*Safety*）
＋
安全供給（*Energy Security*）
経済効率性（*Economic Efficiency*）
環境適合（*Environment*）

【“S＋3E”を満たすVRFBを展開するLEシステムの取組み】

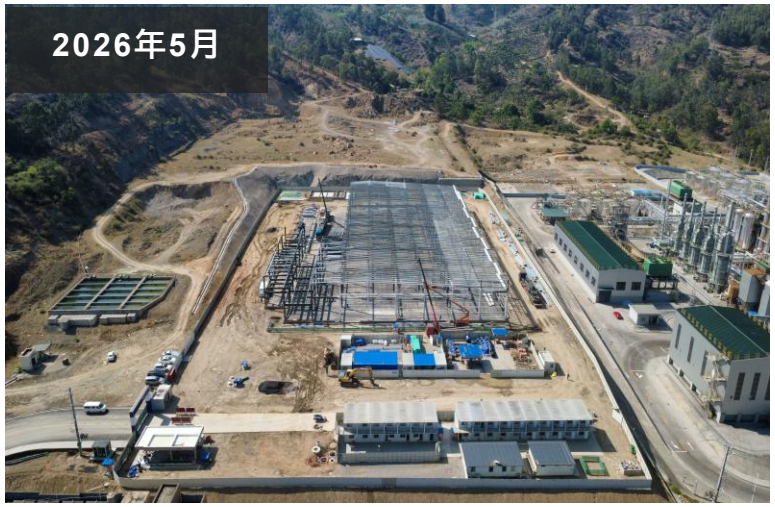
2040ビジョン達成に向けた重要課題の1つ
「再生可能エネルギーの安定供給」に、
大型蓄電システムVRFBの貢献チャンスを見込む

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

エネルギー事業（事業進捗／中国市場動向）

- パートナー企業との合弁事業として、中国国内に電解液のマザープラントとして攀枝花工場を建設
- 2026年10月、同工場の竣工式を執り行い、VRFB用電解液の生産を開始









中国市場動向

中国VRFBプロジェクト情報（2025年実績）

■VRFB新規設置規模

4,179MWh

■容量前年比

+140%

出所：各種資料よりRST調べ

攀枝花工場VRFB用電解液生産能力計画
2027年中　30,000㎥／年　2028年中　60,000㎥／年

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

艾索精密部件（惠州）有限公司（RSPDH）

・2024年12月、M＆Aにより光学ピックアップモジュール・車載カメラモジュールの製造販売事業を承継



社　　名	艾索精密部件（惠州）有限公司
設　　立	1995年11月20日（事業承継日：2024年12月）
資　本　金	555百万元
事業内容	光学ピックアップモジュール・ 車載カメラモジュールの製造・販売
所　在　地	中国広東省恵州仲恺高新区

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

地域戦略

日本・北米・欧州

三本木工場（日本旗艦工場）が北米、欧州、日本等を中心にカバー





ウェーハ再生事業：米国の政権交代による関税影響は軽微

米中摩擦の影響を回避するため、米中間の取引は行わない戦略

中 国

現時点でプライムウェーハは中国国内を中心に販売



台 湾

ファウンドリーの集積地である台湾地域内は台南工場でカバー



COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

取締役の体制

・ガバナンス体制強化のため2022年3月に監査等委員会設置会社に組織形態を変更

社内取締役



方　永義
代表取締役社長
1998年　永輝商事設立
2010年　当社設立社長就任(現任)
DG Technologiesの代表取締役社長、
台湾、中国の子会社の董事長を兼任



遠藤　智
取締役上席執行役員
製造部長
1991年　ラサ工業入社
2011年　当社入社
2017年　当社取締役就任(現任)
DG Technologies取締役、
台湾、中国の董事を兼任



大澤　一生
取締役上席執行役員

2006年　永輝商事入社
2012年　当社入社
2023年　当社取締役就任(現任)
LEシステム代表取締役社長を兼任



戸松　清秀
取締役上席執行役員
経営管理本部・経営戦略本部部長
2020年　きらぼし銀行入行
2023年　当社入社
2024年　当社取締役就任(現任)
艾索精密部件(惠州)有限公司董事長を兼任

独立社外取締役

中野　隆喜
取締役
2013年　株式会社UACJ取締役兼常務執行役員
2026年 当社取締役就任(現任)

金森　浩之
取締役監査等委員
1988年　監査法人朝日親和会計社社入所
2022年　当社取締役就任(現任)
金森公認会計士事務所所長、
みなと公認会計士共同事務所代表、
上場企業の社外取締役を兼任

張　翠萍
取締役監査等委員
2004年　中国律師登録
2011年　外国法事務弁護士(中国法)登録
2024年　当社取締役就任(現任)
西村あさひ法律事務所・
外国法共同事業パートナーを兼任

伊澤　太郎
取締役監査等委員
1981年　凸版印刷入社
同社取締役、常務取締役を経て
2024年　当社取締役就任(現任)

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

代表取締役　方永義の強み

- 代表取締役社長である方永義が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした
  全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力 が強み
- 方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結



方　永義（ほう　ながよし）

- 1970年生まれ　中国福建省出身
- 城西国際大学院　経営学博士
- 1998年　永輝商事設立
- 2010年　当社設立社長就任（現任）
- 2014年　日本に帰化

得意分野
M&A、業務提携

大切にしている心
為せば成る

補足
- 高校卒業後に来日。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験
- 「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

Appendix

04

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

三本木工場 （RS Technologies、ウェーハ再生事業）

- 2011年1月 操業開始、2015年6月 最先端設備を導入した第8工場にて生産開始
- 半導体市況の成長が加速する中、強まる需要に対応するために、第7工場への設備投資を決定
- 第7工場は、2026年中に稼働開始予定





社　　名	株式会社RS Technologies
製　　品	5,6,8,12インチ再生ウェーハ
生産能力	8インチ　：　月産15万枚 12インチ　：　月産34万枚 第7工場増産計画(月産)：2026年4万枚、2027年12万枚、2028年17万枚
所在地	宮城県大崎市
認　　証	ISO9001、ISO14001

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

台南工場 （RSTW、ウェーハ再生事業）

- 2015年12月、艾爾斯半導體股份有限公司（RSTW）台南工場生産開始
- 2027年～、台南第2工場が稼働予定





社　　名	艾爾斯半導體股份有限公司
設　　立	2015年12月
製　　品	12インチ再生ウェーハ
生 産 能 力	12インチ ： 月産30万枚 第2工場増産計画（月産）：2027年5万枚、 2028年20万枚、2029年25万枚、2030年30万枚
所　在　地	台湾台南市
認　　証	ISO9001、ISO14001

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

徳州工場 （山東Gritek、8インチプライムウェーハ事業）

- 2018年8月、山東有研半導体材料有限公司(Gritekの連結子会社、山東Gritek）を設立
- 2020年10月、新工場が竣工を迎え、プライムウェーハの新たな製造拠点として稼働開始





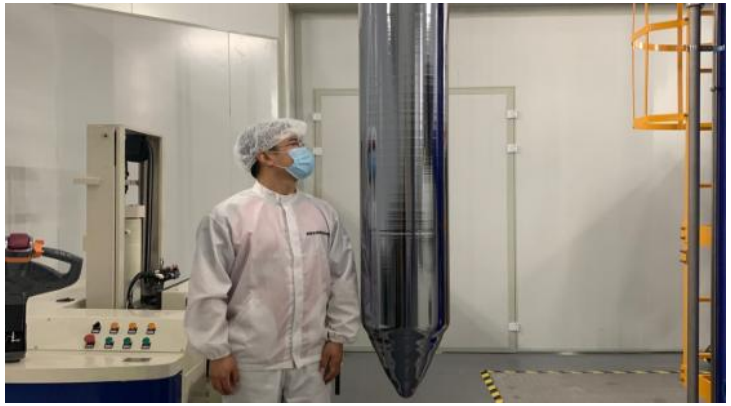
社　　名	山東有研半導体材料有限公司
設　　立	2020年10月
製　　品	5,6,8インチプライムウェーハ
生産能力	5インチ　：　月産5万枚 6インチ　：　月産20万枚 8インチ　：　月産25万枚
所在地	中国山東省徳州市
認　　証	ISO9001、ISO14001

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

SGRS研究開発センター（SGRS、12インチプライムウェーハ事業）

- 2020年3月、持分法適用子会社　山東有研RS半導体材料有限公司（SGRS）を設立
- 2021年に月産1万枚の開発ラインを設置→2021年から12インチプライムウェーハの研究開発及び生産を開始





社　　名	山東有研RS半導体材料有限公司
設　　立	2020年3月
製　　品	①12インチプライムウェーハ ②12インチ再生ウェーハ
生 産 能 力	①月産10万枚、開発ライン月産1万枚 ②月産5万枚
所　在　地	中国山東省徳州市

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

栗原工場・神栖工場（DG Technologies、半導体関連装置・部材等事業）

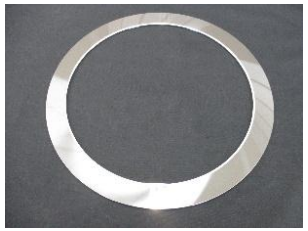
- 2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ
- 従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場（新設）の2拠点体制で、増加する受注に対応

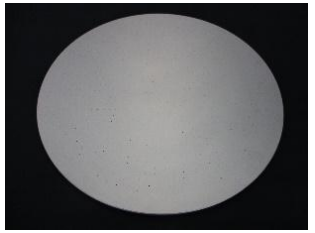


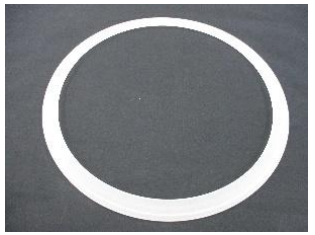
DG Technologies　栗原工場



DG Technologies　神栖工場







社　　名	株式会社DG Technologies
稼働開始	2021年5月
製　　品	ドライエッチング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所 在 地	宮城県栗原市
認　　証	ISO9001、ISO14001

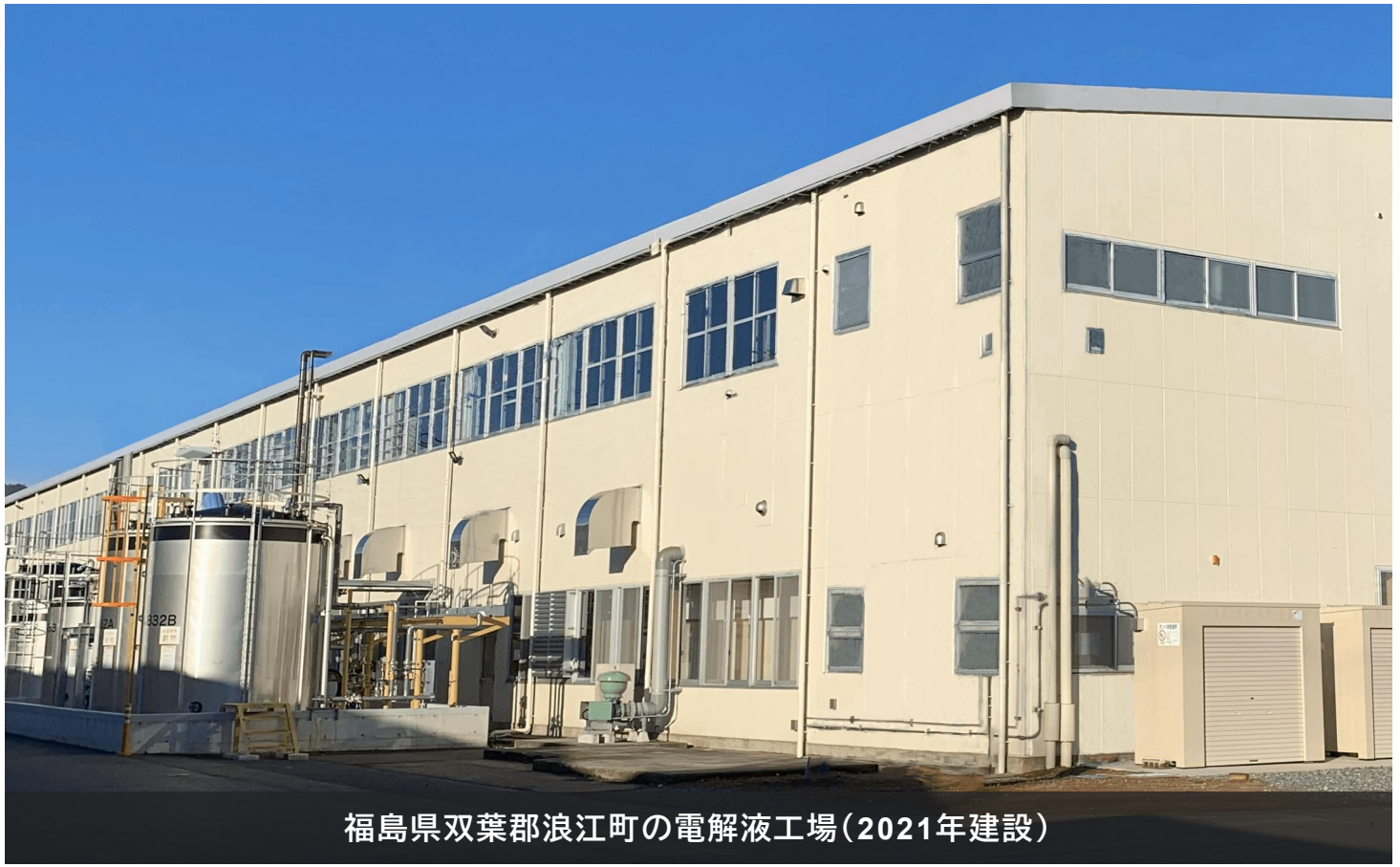
社　　名	株式会社DG Technologies
設　　立	1981年10月
製　　品	ドライエッチング装置向け 石英・シリコン製消耗部材
所 在 地	茨城県神栖市
認　　証	ISO9001、ISO14001

RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

浪江工場 （LEシステム、半導体関連装置・部材等事業）

- **2023年12月、当社が旧LEシステムの電解液製造事業※1 を全面的に承継**

  ※1　旧LEシステムの基幹技術は日本で生まれた技術であり、株式会社INCJ(官民ファンド)の出資を含む多くの支援を受けてきた



福島県双葉郡浪江町の電解液工場（2021年建設）



茨城県つくば市の事業所
（2013年建設。技術研究/パイロットプラント）

社　　名	株式会社LEシステム
設　　立	2023年10月13日（事業承継日：2023年12月）
事業内容	バナジウムレドックスフロー電池の電解液製造
生産能力	年間約5,000㎥
所　在　地	福島県双葉郡浪江町（工場） 茨城県つくば市（事業所）

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

業績推移

(百万円)	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
売上高	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561	34,620	49,864	51,893	59,200	76,707
売上総利益	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681	11,870	18,432	17,413	19,380	23,585
販管費	958	1,269	2,615	3,223	4,151	4,995	5,413	5,519	6,271	9,303
営業利益	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530	6,874	13,018	11,894	13,108	14,281
経常利益	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252	8,832	15,500	14,921	15,668	16,635
当期利益(※1)	861	2,113	3,620	3,035	2,824	3,303	7,739	7,703	9,446	9,297
配当金(円) (※2)	10	5	10	15	20	25	35	30	35	45
設備投資	209	95	1,328	4,809	12,409	7,827	5,379	5,999	8,786	8,419
減価償却費	682	714	1,298	1,814	1,674	2,942	3,498	3,774	4,199	5,547
研究開発費	85	183	501	449	929	1,308	1,657	1,764	1,647	1,916
従業員数 (正社員)(人)	373	434	1,159	1,277	1,187	1,333	1,533	1,534	2,614	2,744

(※1)親会社株主に帰属する当期純利益　(※2)2023年度の配当は2023年1月1日の分割(1/2)後にて表示

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

主要財務諸表

（百万円）	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
資産の部										
流動資産	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626	45,804	90,470	96,409	124,894	135,354
現金及び預金	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082	25,438	67,939	70,758	85,224	96,771
受取手形及び売掛金	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321	9,517	11,651	12,673	23,417	22,322
商品及び製品	348	446	1,343	1,713	2,116	2,783	3,833	6,507	6,678	5,677
固定資産	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124	33,206	37,084	44,256	57,252	69,867
有形固定資産	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146	29,023	31,285	35,326	45,575	49,485
無形固定資産	23	19	1,099	732	527	417	270	266	689	669
投資その他資産	158	149	453	506	1,451	3,766	5,529	8,663	10,987	19,712
資産合計	**10,682**	**12,231**	**36,591**	**48,634**	**58,750**	**79,010**	**127,554**	**140,666**	**182,146**	**205,222**
負債の部										
流動負債	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631	14,171	17,622	18,265	34,804	31,286
支払手形及び買掛金	283	398	1,554	1,614	2,871	4,317	6,466	5,174	8,302	9,890
有利子負債	1,538	1,277	976	1,730	1,728	3,244	4,888	3,502	9,364	7,300
固定負債	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754	9,827	8,458	6,973	11,794	20,605
有利子負債	3,662	2,798	1,872	3,373	2,780	6,170	4,480	3,162	2,915	16,140
負債合計	**7,310**	**6,705**	**7,453**	**12,652**	**18,385**	**23,999**	**26,081**	**25,238**	**46,598**	**51,891**
純資産の部										
純資産	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365	55,011	101,473	115,428	135,548	153,331
負債・純資産合計	**10,682**	**12,231**	**36,591**	**48,634**	**58,750**	**79,010**	**127,554**	**140,666**	**182,146**	**205,222**

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

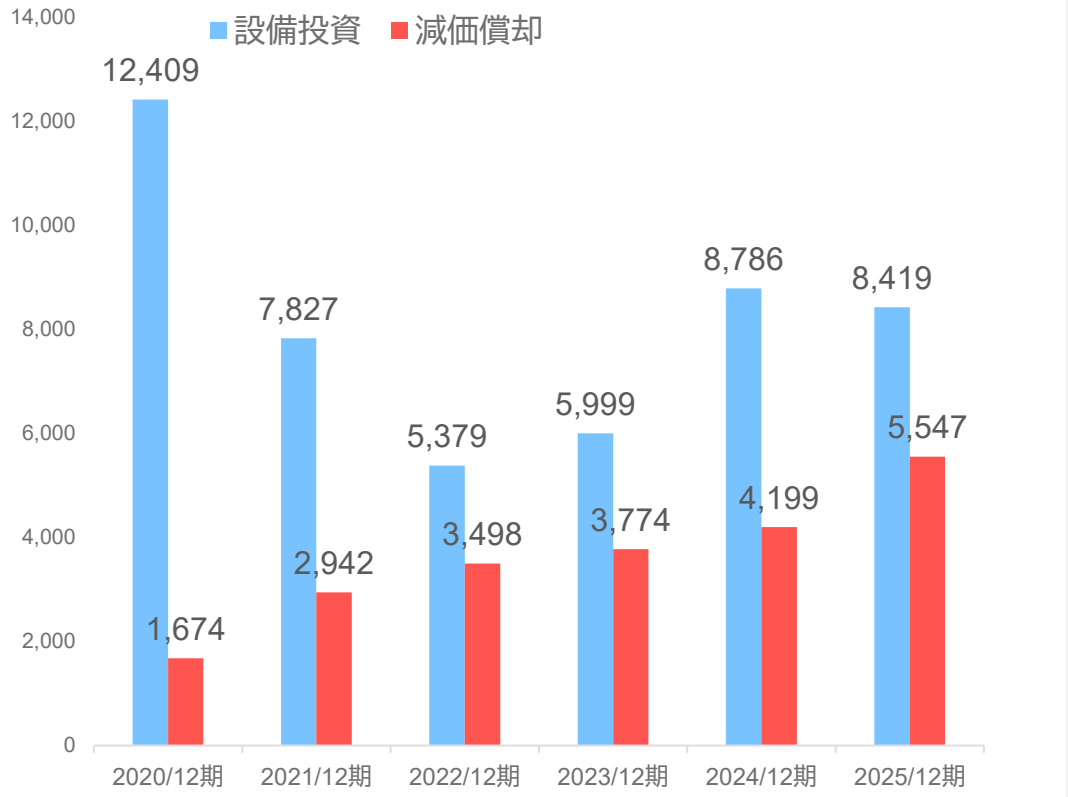
セグメント別 業績推移

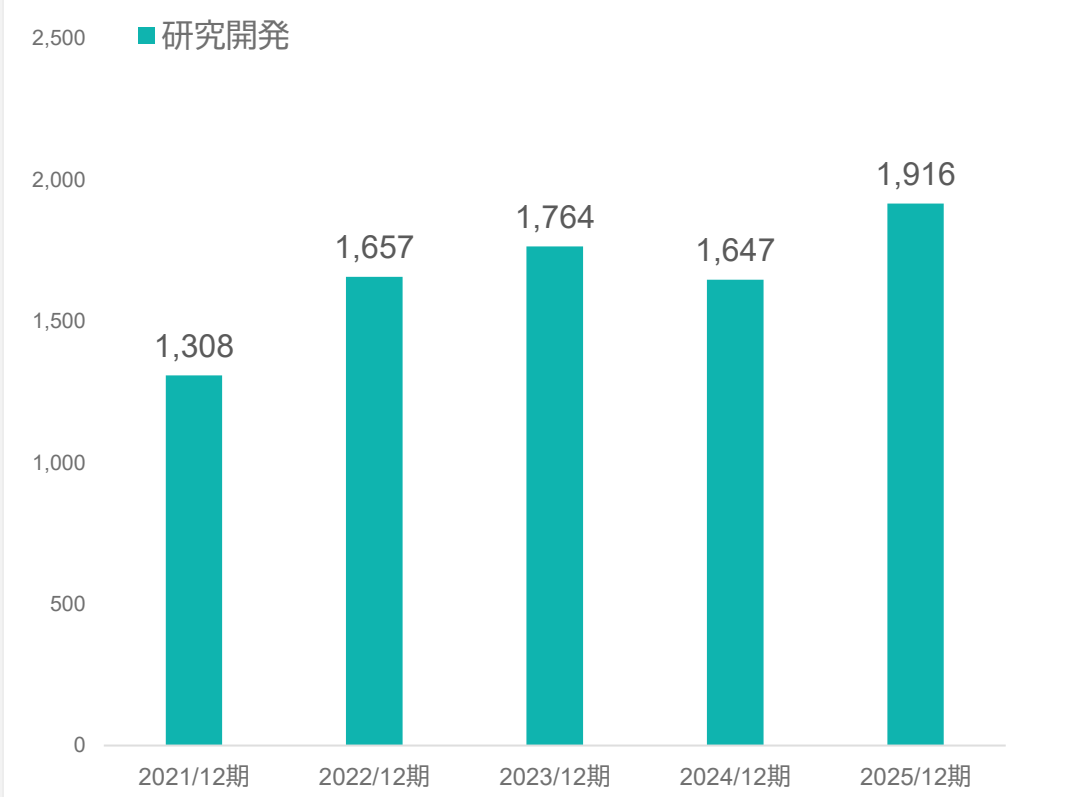
（百万円）	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
売上高										
ウェーハ再生事業	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461	12,717	18,001	20,499	23,794	27,529
プライムウェーハ製造販売事業	–	–	11,918	10,058	8,755	14,780	22,752	18,736	20,443	20,893
半導体関連装置・部材等	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272	8,450	11,265	14,057	16,283	30,469
その他、調整額	66	52	△331	△380	△927	△1,327	△2,154	△1,399	△1,320	△2,185
セグメント利益										
ウェーハ再生事業	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027	4,731	7,312	8,114	9,059	10,167
プライムウェーハ製造販売事業	–	–	2,048	1,503	1,041	2,539	5,995	3,742	4,743	4,159
半導体関連装置・部材等	230	130	366	171	211	382	914	882	884	1,624
その他、調整額	△409	△543	△675	△1,038	△749	△778	△1,203	△844	△1,578	△1,669
セグメント資産										
ウェーハ再生事業	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698	14,302	18,530	21,833	26,163	32,705
プライムウェーハ製造販売事業	–	–	21,313	29,311	35,697	53,202	95,788	100,768	116,144	123,166
半導体関連装置・部材等	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387	7,310	6,801	8,775	31,014	30,538
その他、調整額	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968	4,243	6,435	9,290	8,823	18,811

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

研究開発費・設備投資

- 更なる成長を目指し、継続的な設備投資、研究開発を継続





COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

ご留意事項

当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性がございます。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

COPYRIGHT© RS TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED